

证券代码：300726

股票简称：宏达电子



关于株洲宏达电子股份有限公司 申请向特定对象发行股票的审核问询函 的回复报告

保荐机构（主承销商）



（北京市朝阳区建国门外大街1号国贸大厦2座27层及28层）

二〇二一年九月

深圳证券交易所：

根据贵所于 2021 年 9 月 3 日出具的《关于株洲宏达电子股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核问询函》（审核函〔2021〕020235 号），株洲宏达电子股份有限公司（以下简称“宏达电子”、“公司”、“发行人”）与保荐机构中国国际金融股份有限公司（以下简称“保荐机构”）、北京金杜（成都）律师事务所（以下简称“发行人律师”）、众华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“会计师”）对问询函所涉及的问题认真进行了逐项核查和落实，同时按照审核问询函的要求对《株洲宏达电子股份有限公司 2021 年度向特定对象发行 A 股股票募集说明书（申报稿）》（以下简称“募集说明书”）进行了修订和补充，现回复如下，请予审核。

如无特别说明，本回复报告中的简称与《株洲宏达电子股份有限公司 2021 年度向特定对象发行 A 股股票募集说明书（修订稿）》中“释义”所定义的简称具有相同含义，所用字体对应内容如下：

审核中心意见落实函所列问题	黑体、加粗
对审核中心意见落实函所列问题的回答	宋体
涉及对募集说明书等申请文件的修改内容	楷体、加粗

本回复报告中若出现部分合计数与各加数直接相加之和在尾数上有差异，或部分比例指标与相关数值直接计算的结果在尾数上有差异，这些差异是由四舍五入造成的。

本回复报告中 2021 年 6 月 30 日、2021 年 1-6 月相关财务数据未经审计。

目 录

目 录.....	3
问题一.....	4
问题二.....	26
问题三.....	41
问题四.....	49
问题五.....	55
问题六.....	78
问题七.....	93
其他问题	102

问题一

报告期各期末，发行人的应收账款及应收票据占营业收入比重分别为122.80%、116.82%、102.00%和171.72%，截至2021年6月30日发行人应收账款及应收票据金额为15.85亿元，商业承兑汇票余额5.37亿元，商业承兑汇票占应收票据余额的99.60%。报告期各期，发行人的净利润为21,898.10万元、30,906.42万元、52,918.67万元和43,296.37万元，报告期各期经营活动现金净流入为-3,818.06万元、8,256.76万元、25,662.54万元、24,070.17万元，显著低于净利润水平。

请发行人补充说明：（1）结合主要客户销售结算模式、对应销售金额及应收款项、款项回收周期、同行业可比公司情况等补充说明应收款项占营业收入比重较高的原因及合理性，坏账准备计提是否充分，是否存在到期无法收回的风险；（2）商业承兑汇票对应的主要客户情况，包括但不限于客户名称、金额、合作时间、使用商业承兑汇票是否符合与主要客户的交易习惯，是否存在无法兑付风险，坏账准备计提是否充分合理；（3）结合同行业可比公司情况、公司采购和销售模式等补充说明经营活动现金流量净额长期低于净利润水平的原因及合理性。

请发行人补充披露（1）（2）相关的风险。

请保荐人和会计师核查并发表明确意见。

回复：

一、对问题的回复

（一）结合主要客户销售结算模式、对应销售金额及应收款项、款项回收周期、同行业可比公司情况等补充说明应收款项占营业收入比重较高的原因及合理性，坏账准备计提是否充分，是否存在到期无法收回的风险

1、结合主要客户销售结算模式、对应销售金额及应收款项、款项回收周期、同行业可比公司情况等补充说明应收款项占营业收入比重较高的原因及合理性

（1）发行人主要客户对应销售金额及应收款项

发行人主要客户为大型高可靠集团，报告期各期前五大集团客户所对应的当

期收入、期末应收账款余额、期末应收票据余额如下表所示：

单位：万元

前五大集团名称	当期收入金额	应收账款余额	应收票据余额
2021年1-6月/2021年6月30日			
中国航空工业集团有限公司	23,188.47	32,267.68	24,107.30
中国电子科技集团有限公司	15,502.95	19,641.46	9,621.16
中国兵器装备集团有限公司	6,852.86	5,416.04	1,349.83
中国航天科工集团有限公司	6,105.77	9,739.49	3,819.00
中国航天科技集团有限公司	5,506.80	8,370.69	1,976.21
前五大合计	57,156.85	75,435.36	40,873.51
前五大合计占比	61.95%	68.32%	72.74%
2020年度/2020年12月31日			
中国航空工业集团有限公司	39,220.83	30,150.53	29,531.48
中国电子科技集团有限公司	24,108.76	7,956.70	17,510.24
中国航天科技集团有限公司	8,259.13	3,321.51	4,350.40
中国兵器装备集团有限公司	8,153.57	2,319.05	4,519.12
中国航天科工集团有限公司	7,800.46	4,201.30	4,972.69
前五大合计	87,542.75	47,949.09	60,883.92
前五大合计占比	62.49%	67.78%	76.16%
2019年度/2019年12月31日			
中国航空工业集团有限公司	29,344.11	24,646.82	21,924.36
中国电子科技集团有限公司	14,008.79	6,921.82	10,528.16
中国兵器装备集团有限公司	4,862.00	2,318.20	2,742.55
中国航天科工集团有限公司	4,444.46	3,862.80	2,494.03
中国航天科技集团有限公司	2,375.10	1,410.43	1,530.06
前五大合计	55,034.47	39,160.07	39,219.17
前五大合计占比	65.20%	69.55%	81.27%
2018年度/2018年12月31日			
中国航空工业集团有限公司	23,422.58	21,146.99	17,396.71
中国电子科技集团有限公司	11,099.20	5,139.73	7,324.41
中国航天科工集团有限公司	5,173.59	3,074.07	5,285.65
中国兵器工业集团有限公司	2,731.05	1,329.92	1,602.58
中国航天科技集团有限公司	1,902.84	1,327.98	1,004.68

前五大集团名称	当期收入金额	应收账款余额	应收票据余额
前五大合计	44,329.26	32,018.69	32,614.04
前五大合计占比	69.67%	73.44%	82.86%

注：发行人主要客户回款时间多数集中在下半年，故发行人截至 2021 年 6 月 30 日应收款项金额较大。

（2）发行人主要客户的销售结算模式及款项回收周期

①销售结算模式

发行人对主要客户的销售结算方式以赊销为主，客户回款方式主要为银行存款现付、商业承兑汇票及银行承兑汇票。报告期各期，发行人客户回款方式及占比情况如下表所示：

单位：万元

回款方式	2021 年 1-6 月	2020 年度	2019 年度	2018 年度
银行存款及其他	51.51%	34.98%	26.96%	27.82%
商业承兑汇票	39.72%	51.17%	59.84%	62.99%
银行承兑汇票	8.77%	13.85%	13.20%	9.19%
合计	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%

报告期各期，发行人以汇票形式回款的比例分别为 72.18%、73.04%、65.02%、48.49%，以银行存款及其他形式回款的比例分别为 27.82%、26.96%、34.98%、51.51%。

②款项回款周期

发行人主要客户群体为大型高可靠集团，此类客户在与发行人签订的合同中一般对付款条件及付款期限无特别约定。高可靠产品制造产业链较长，产品验收涉及单位较多，发行人货物发出到客户验收合格一般历时较长，验收合格后高可靠产业集团内部严格的付款审核手续亦会延长付款进度，且发行人存在大量以商业汇票形式回款的情形，而商业汇票最长付款期限为 12 个月，进而导致公司应收款项回款周期较长，通常从客户确认货物验收入库到付款时间一般在 12 个月左右。

(3) 同行业可比公司情况

单位：万元

公司名称	应收款项 账面价值	自产业务 收入	代理业务 收入	自产业务 占营业收 入比重	代理业务 占营业收 入比重	营业收入	应收款项 占营业收 入比重
2021年1-6月/2021年6月30日							
火炬电子	220,676.15	86,479.17	154,717.24	35.85%	64.15%	241,196.41	91.49%
振华科技	433,866.20	281,666.48	-	100.00%	-	281,666.48	154.04%
鸿远电子	204,879.93	75,870.94	49,227.37	60.65%	39.35%	125,098.31	163.78%
平均值	286,474.09	148,005.53	67,981.54	65.50%	34.50%	215,987.07	136.43%
发行人	158,487.41	92,269.95	-	100.00%	-	92,269.95	171.76%
2020年度/2020年12月31日							
火炬电子	224,916.93	118,416.56	247,208.12	32.39%	67.61%	365,624.68	61.52%
振华科技	370,092.60	394,973.10	-	100.00%	-	394,973.10	93.70%
鸿远电子	154,849.99	89,200.37	80,803.17	52.47%	47.53%	170,003.54	91.09%
平均值	249,953.17	200,863.34	109,337.10	61.62%	38.38%	310,200.44	82.10%
发行人	142,881.44	140,085.76	-	100.00%	-	140,085.76	102.00%
2019年度/2019年12月31日							
火炬电子	162,533.25	82,772.33	174,167.02	32.21%	67.79%	256,939.34	63.26%
振华科技	311,635.47	366,828.18	-	100.00%	-	366,828.18	84.95%
鸿远电子	100,339.85	59,239.60	46,206.33	56.18%	43.82%	105,445.93	95.16%
平均值	191,502.85	169,613.37	73,457.78	62.80%	37.20%	243,071.15	81.12%
发行人	98,568.79	84,404.17	-	100.00%	-	84,404.17	116.78%
2018年度/2018年12月31日							
火炬电子	119,163.22	60,350.94	142,083.75	29.81%	70.19%	202,434.69	58.87%
振华科技	408,195.55	533,757.15	-	100.00%	-	533,757.15	76.48%
鸿远电子	82,666.84	49,110.76	43,232.33	53.18%	46.82%	92,343.09	89.52%
平均值	203,341.87	214,406.28	61,772.03	61.00%	39.00%	276,178.31	74.95%
发行人	78,136.74	63,631.46	-	100.00%	-	63,631.46	122.80%

注1：在计算2021年6月30日应收款项账面价值占营业收入的比例时，营业收入未采用年化方式。

注2：自2019年1月1日起，火炬电子、振华科技、鸿远电子按照新金融工具准则将银行承兑汇票调整至应收款项融资科目，故三家可比公司应收款项计算口径包含应收账款账面价值、应收票据账面价值、应收款项融资账面价值。

注3：火炬电子的其他业务收入放入自产业务收入进行计算。

报告期各期，发行人应收款项账面价值占营业收入比例分别为 122.80%、116.78%、102.00%、171.76%，高于可比公司比例的平均值 74.95%、81.12%、82.10%、136.43%。发行人应收款项占营业收入的比重高于同行业可比公司的原因主要如下：

①发行人与同行业可比公司所销售产品结构及客户群体存在一定差异。发行人主要以自产高可靠产品销售为主，发行人客户群体主要为高可靠产业集团及其下属关联公司，此类客户经费一般来自国家拨付，其付款进度依赖于整体项目的拨款进度，且其内部付款审核程序繁杂，付款周期相对较长。

可比公司火炬电子、鸿远电子代理业务收入占营业收入比例较高，由于代理业务主要面向民用消费类市场客户，回款速度相对较快，相应拉低了应收款项占营业收入的比例。

可比公司振华科技于 2018 年度、2019 年度将其 7 家子公司账面价值分别为 38,065.21 万元、58,572.17 万元的一年以内应收账款债权评估作价转让给中国电子信息产业集团有限公司进行融资，并于 2019 年度将其全资子公司中国振华集团宇光电工有限公司持有的账面价值 2,165.80 万元的应收账款债权与中电惠融商业保理（深圳）有限公司开展无追索权保理业务，故而导致其 2018 年度、2019 年度应收款项占营业收入的比例较低。

②发行人正处于高速发展阶段，报告期各期营业收入同比增长的比率分别为 21.35%、32.65%、65.97%和 77.53%，高于行业内其他上市公司收入增长比率的均值。振华科技 2018 年、2019 年营业收入下降，系其压缩了现代服务业等低附加值业务。

单位：万元

公司名称	2021 年 1-6 月		2020 年		2019 年		2018 年	
	金额	增速	金额	增速	金额	增速	金额	增速
火炬电子	241,196.41	60.92%	365,624.68	42.30%	256,939.34	26.92%	202,434.69	7.21%
振华科技	281,666.48	39.10%	394,973.10	7.67%	366,828.18	-31.27%	533,757.15	-33.43%
鸿远电子	125,098.31	80.56%	170,003.54	61.22%	105,445.93	14.19%	92,343.09	25.35%
平均值	215,987.07	60.19%	310,200.44	37.06%	243,071.15	3.28%	276,178.31	-0.29%
发行人	92,269.95	77.53%	140,085.76	65.97%	84,404.17	32.65%	63,631.46	21.35%

2、应收款项坏账准备计提情况

(1) 应收款项坏账准备计提情况

报告期各期末，发行人应收账款坏账准备计提情况如下表所示：

单位：万元

项目	2021年 6月30日	2020年 12月31日	2019年 12月31日	2018年 12月31日
应收账款账面余额	110,421.47	70,738.96	56,306.30	43,596.26
坏账准备	5,883.67	4,857.16	4,258.13	3,396.26
应收账款账面价值	104,537.80	65,881.80	52,048.17	40,200.00
坏账准备计提比例	5.33%	6.87%	7.56%	7.79%

报告期各期末，发行人应收账款坏账准备计提金额分别为 3,396.26 万元、4,258.13 万元、4,857.16 万元、5,883.67 万元，计提比例分别为 7.79%、7.56%、6.87%、5.33%。

报告期各期末，发行人应收票据坏账准备计提情况如下表所示：

单位：万元

项目	2021年 6月30日	2020年 12月31日	2019年 12月31日	2018年 12月31日
应收票据账面余额	56,188.49	79,942.45	48,260.28	39,361.19
坏账准备	2,238.88	2,942.82	1,739.66	1,424.45
应收票据账面价值	53,949.61	76,999.63	46,520.62	37,936.74
坏账准备计提比例	3.98%	3.68%	3.60%	3.62%

报告期各期末，发行人应收票据坏账准备计提金额分别为 1,424.45 万元、1,739.66 万元、2,942.82 万元、2,238.88 万元，计提比例分别为 3.62%、3.60%、3.68%、3.98%。

(2) 发行人应收款项坏账计提的会计政策、计提比例，及与同行业上市公司对比情况

① 发行人应收款项坏账准备政策与同行业可比上市公司基本一致

A、2019 年度、2020 年度应收款项坏账计提政策分析

公司名称	会计政策

<p>发行人</p>	<p>对于应收票据及应收账款，无论是否存在重大融资成分，公司均按照整个存续期的预期信用损失计量损失准备。</p> <p>当单项应收票据及应收账款无法以合理成本评估预期信用损失的信息时，公司依据信用风险特征将应收票据及应收账款划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失。如果有客观证据表明某项应收票据及应收账款已经发生信用减值，则公司对该应收票据及应收账款单项计提坏账准备并确认预期信用损失。对于划分为组合的应收票据及应收账款，公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。</p> <p>公司应收票据组合包括：（1）银行承兑票据；（2）评估为正常的、低风险的商业承兑汇票；应收账款组合包括：（1）账龄组合；（2）应收合并范围内关联方款项；（3）单项计提组合。</p>
<p>火炬电子</p>	<p>对于应收票据、应收账款、应收款项融资，无论是否存在重大融资成分，公司均按照整个存续期的预期信用损失计量损失准备。</p> <p>对于存在客观证据表明存在减值，以及其他适用于单项评估的应收票据、应收账款、应收款项融资等单独进行减值测试，确认预期信用损失，计提单项减值准备。对于不存在减值客观证据的应收票据、应收账款、应收款项融资或当单项金融资产无法以合理成本评估预期信用损失的信息时，公司依据信用风险特征将应收票据、应收账款、应收款项融资等划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失。</p> <p>公司应收票据组合为商业承兑汇票组合；应收账款组合包含：（1）应收合并范围内关联方客户；（2）应收军品研发经费等低风险款项；（3）应收其他销货款；应收款项融资组合为银行承兑汇票组合。</p> <p>对于划分为组合的应收票据，公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。</p>
<p>振华科技</p>	<p>针对应收票据、应收款项融资，公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。针对应收账款，公司对信用风险显著不同的应收账款单项评价信用风险，如：应收关联方款项；与对方存在争议或涉及诉讼、仲裁的应收款项；已有明显迹象表明债务人很可能无法履行还款义务的应收款项等。</p> <p>除了单项评估信用风险的应收账款外，公司基于共同风险特征将应收账款划分为不同的组别，在组合的基础上评估信用风险。</p>
<p>鸿远电子</p>	<p>集团以预期信用损失为基础，对应收账款、应收票据、应收款项融资按照其适用的预期信用损失计量方法计提减值准备并确认信用减值损失。公司的应收票据组合为商业承兑汇票账龄组合；公司的应收账款组合可分为：（1）应收账款账龄组合；（2）应收账款关联方组合；公司的应收款项融资组合为银行承兑汇票组合。</p>

基于上表的分析，自 2019 年 1 月 1 日起，发行人与同行业可比公司的应收账款坏账准备计提政策不存在重大差异。

B、2018 年度应收款项坏账计提政策分析

<p>公司名称</p>	<p>会计政策</p>
<p>发行人</p>	<p>（1）单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项</p> <p>①单项金额重大的判断依据或金额标准：应收账款年末余额 100 万元以上。</p> <p>②单项金额重大并单独计提坏账准备的计提方法：根据该款项预计未来现金流</p>

公司名称	会计政策
	<p>量现值低于其账面价值的差额，单独进行减值测试，计提坏账准备。</p> <p>(2) 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项</p> <p>①组合 1：账龄组合，使用账龄分析法。</p> <p>②组合 2：合并范围内关联方组合，使用其他方法。</p> <p>(3) 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项</p> <p>①单独计提坏账准备的理由：发生诉讼、债务人破产或死亡等应收款项。</p> <p>②坏账准备的计提方法：单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备。</p> <p>(4) 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收商业承兑汇票：划分为账龄组合，按照账龄分析法计提坏账准备。</p>
火炬电子	<p>(1) 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项</p> <p>①单项金额重大的判断依据或金额标准：期末余额达到 100 万元（含 100 万元）以上的应收款项为单项金额重大的应收款项。</p> <p>②单项金额重大并单独计提坏账准备的计提方法：对于单项金额重大的应收款项单独进行减值测试，有客观证据表明发生了减值，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。单项金额重大经单独测试未发生减值的应收款项，再按组合计提坏账准备。</p> <p>(2) 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项</p> <p>将组合划分为：①组合 1：应收销货款及除组合 2、3、4、5、6 之外的其他应收款项，使用账龄分析法；②组合 2：应收合并范围内关联方款项，使用个别认定法；③组合 3：代理进口销货款，使用个别认定法；④组合 4：各类保证金及押金，使用个别认定法；⑤组合 5：职工备用金及其他，使用个别认定法；⑥组合 6：应收军品研发经费，使用个别认定法；⑦组合 7：应收票据，银行承兑汇票不计提坏账准备，商业承兑汇票，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。</p> <p>(3) 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项</p> <p>①单项计提坏账准备的理由：涉诉款项、客户信用状况恶化的应收款项。</p> <p>②坏账准备的计提方法：根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。</p>
振华科技	<p>(1) 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项</p> <p>①单项金额重大的判断依据或金额标准：公司于资产负债表日，将应收账款余额大于 100.00 万元，其他应收款余额大于 100.00 万元的应收款项划分为单项金额重大的应收款项。</p> <p>②单项金额重大并单独计提坏账准备的计提方法：逐项进行减值测试，有客观证据表明其发生了减值的，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备。</p> <p>(2) 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项：</p> <p>①针对采用账龄分析法计提坏账的组合，按照不同账龄对应不同计提比例的方法计提。</p> <p>②对行政事业单位及信誉好的客户（指客户严格按照交易合同期付款，业务往来时间在二年以上，无拖欠货款记录的）可不计提坏账准备；对银行承兑汇票可不计提坏账准备；对纳入中国振华（集团）科技股份有限公司合并报表范围内的企业之间的往来款原则上不计提坏账准备，如有客观证据表明其发生了减值的，采用个别认定法，单独确认减值损失。</p> <p>(3) 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项</p> <p>①单项计提坏账准备的理由：对于单项金额非重大的应收款项，如果有客观证据表明其发生了减值的应收款项，单独确认减值损失。</p> <p>②坏账准备的计提方法：个别认定法。</p>
鸿远电子	<p>(1) 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项</p>

公司名称	会计政策
	<p>①单项金额重大的判断依据或金额标准：公司将金额为人民币 200 万元以上的应收款项确认为单项金额重大的应收款项。</p> <p>②单项金额重大并单独计提坏账准备的计提方法：公司对单项金额重大的应收款项单独进行减值测试，单独测试未发生减值的金融资产，包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。单项测试已确认减值损失的应收款项，不再包括在具有类似信用风险特征的应收款项组合中进行减值测试。</p> <p>（2）按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项： ①账龄组合，按账龄分析法计提坏账准备；②关联方组合：合并范围内的关联方应收款项，使用个别认定法；③保证金、备用金及其他组合：使用个别认定法。</p> <p>（3）单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收款项 公司对于单项金额虽不重大但具备以下特征的应收款项，单独进行减值测试：有客观证据表明其发生了减值的，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备；应收关联方款项；与对方存在争议或涉及诉讼、仲裁的应收款项；已有明显迹象表明债务人很可能无法履行还款义务的应收款项等。</p>

基于上表的分析，2018 年，发行人与同行业可比公司的坏账准备计提政策不存在重大差异。

②发行人应收款项计提比例与同行业可比公司平均水平相当

A、应收账款

报告期内，发行人应收账款坏账准备计提比例政策与同行业可比公司比较情况如下：

账龄	振华科技	火炬电子	鸿远电子	发行人
1 年以内	4.00%	3.00%	3.00%	4.00%
1 至 2 年	10.00%	10.00%	10.00%	10.00%
2 至 3 年	30.00%	20.00%	20.00%	30.00%
3 至 4 年	50.00%	50.00%	50.00%	50.00%
4 至 5 年	60.00%	100.00%	100.00%	60.00%
5 年以上	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%

经对比，发行人应收账款坏账准备计提比例与同行业可比公司对比不存在重大差异。

B、应收票据

鉴于三家可比公司火炬电子、振华科技、鸿远电子于 2019 年 1 月 1 日起，按照新金融工具准则将银行承兑汇票调整至应收款项融资科目，故在此仅对发行人与三家可比公司的商业承兑汇票坏账准备的实际计提比例进行对比。

报告期各期末，发行人与可比公司商业承兑汇票坏账准备的实际计提比例对比情况如下：

公司名称	2021 年 6 月 30 日	2020 年 12 月 31 日	2019 年 12 月 31 日	2018 年 12 月 31 日
火炬电子	0.57%	0.37%	0.18%	0.11%
振华科技	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
鸿远电子	8.10%	7.08%	7.32%	7.01%
均值	2.89%	2.48%	2.50%	2.37%
发行人	4.00%	4.00%	4.00%	4.00%

经对比，发行人商业承兑汇票坏账计提比例与同行业可比公司对比不存在重大差异，且相对谨慎。

综上，报告期各期末，发行人应收款项坏账准备计提的会计政策、计提比例与同行业可比公司相比不存在重大差异，发行人坏账准备计提充分。

(3) 发行人应收账款以一年以内为主，且账龄结构有所改善

报告期各期末，发行人应收账款的种类情况如下表所示：

单位：万元

项目	账面余额	比例	坏账准备	计提比例	账面价值
2021 年 6 月 30 日					
单项计提坏账准备	761.50	0.69%	761.50	100.00%	-
按组合计提坏账准备	109,659.97	99.31%	5,122.17	4.67%	104,537.80
合计	110,421.47	100.00%	5,883.67	5.33%	104,537.80
2020 年 12 月 31 日					
单项计提坏账准备	761.50	1.08%	761.50	100.00%	-
按组合计提坏账准备	69,977.46	98.92%	4,095.66	5.85%	65,881.80
合计	70,738.96	100.00%	4,857.16	6.87%	65,881.80
2019 年 12 月 31 日					
单项计提坏账准备	1,037.50	1.84%	1,037.50	100.00%	-

项目	账面余额	比例	坏账准备	计提比例	账面价值
按组合计提坏账准备	55,268.80	98.16%	3,220.63	5.83%	52,048.17
合计	56,306.30	100.00%	4,258.13	7.56%	52,048.17
2018年12月31日					
单项计提坏账准备	1,037.50	2.38%	1,037.50	100.00%	-
按组合计提坏账准备	42,558.76	97.62%	2,358.76	5.54%	40,200.00
合计	43,596.26	100.00%	3,396.26	7.79%	40,200.00

报告期各期末，发行人按账龄组合计提坏账准备的应收账款账面余额分别为42,558.76万元、55,268.80万元、69,977.46万元和109,659.97万元，占发行人应收账款账面余额的比例分别为97.62%、98.16%、98.92%和99.31%。

报告期内，发行人按组合计提坏账准备的应收账款的账龄情况如下表所示：

单位：万元

项目	账面余额	比例	坏账准备	计提比例	账面价值
2021年6月30日					
1年以内	103,924.24	94.77%	4,156.97	4.00%	99,767.27
1至2年	4,659.67	4.25%	465.97	10.00%	4,193.70
2至3年	629.83	0.57%	188.95	30.00%	440.88
3至4年	210.15	0.19%	105.07	50.00%	105.07
4至5年	77.18	0.07%	46.31	60.00%	30.87
5年以上	158.90	0.14%	158.90	100.00%	-
合计	109,659.97	100.00%	5,122.17	-	104,537.80
2020年12月31日					
1年以内	58,342.59	83.37%	2,334.18	4.00%	56,008.41
1至2年	9,873.19	14.11%	986.12	10.00%	8,887.07
2至3年	862.40	1.23%	258.72	30.00%	603.68
3至4年	629.98	0.90%	314.99	50.00%	314.99
4至5年	169.15	0.24%	101.49	60.00%	67.66
5年以上	100.16	0.14%	100.16	100.00%	-
合计	69,977.46	100.00%	4,095.66	-	65,881.80
2019年12月31日					
1年以内	47,026.12	85.09%	1,881.04	4.00%	45,145.08
1至2年	6,336.13	11.46%	633.61	10.00%	5,702.52

项目	账面余额	比例	坏账准备	计提比例	账面价值
2至3年	1,408.38	2.55%	422.51	30.00%	985.86
3至4年	376.16	0.68%	188.08	50.00%	188.08
4至5年	66.58	0.12%	39.95	60.00%	26.63
5年以上	55.44	0.10%	55.44	100.00%	-
合计	55,268.80	100.00%	3,220.63	-	52,048.17
2018年12月31日					
1年以内	37,150.61	87.29%	1,486.02	4.00%	35,664.59
1至2年	4,234.24	9.95%	423.42	10.00%	3,810.82
2至3年	783.39	1.84%	235.02	30.00%	548.37
3至4年	276.75	0.65%	138.37	50.00%	138.37
4至5年	94.62	0.22%	56.77	60.00%	37.85
5年以上	19.15	0.04%	19.15	100.00%	-
合计	42,558.76	100.00%	2,358.76	-	40,200.00

注：自2019年1月1日开始，应收账款按照预期信用损失计提坏账准备。

报告期各期末，发行人按照组合计提的1年以内的应收账款占比分别为87.29%、85.09%、83.37%、94.77%，占比较高，最近一期末占比提升至94.77%，应收账款账龄结构有所优化，且发行人客户以大型高可靠集团等优质客户为主，应收账款回收风险相对较小。

3、发行人应收款项是否存在到期无法收回的风险

(1) 发行人应收款项期后回款情况良好

①应收账款

截至2021年8月31日，发行人报告期各期末应收账款前五大集团期后回款情况如下所示：

单位：万元

前五大集团名称	应收账款余额	期后回款金额	期后回款比例
2021年1-6月/2021年6月30日			
中国航空工业集团有限公司	32,267.68	10,700.49	33.16%
中国电子科技集团有限公司	19,641.46	5,398.89	27.49%
中国航天科工集团有限公司	9,739.49	2,612.54	26.82%

前五大集团名称	应收账款余额	期后回款金额	期后回款比例
中国航天科技集团有限公司	8,370.69	611.78	7.31%
中国兵器装备集团有限公司	5,416.04	989.68	18.27%
合计	75,435.36	20,313.38	26.93%
2020 年度/2020 年 12 月 31 日			
中国航空工业集团有限公司	30,150.53	18,862.89	62.56%
中国电子科技集团有限公司	7,956.70	5,697.43	71.61%
中国航天科工集团有限公司	4,201.30	2,935.53	69.87%
中国航天科技集团有限公司	3,321.51	1,112.92	33.51%
中国兵器装备集团有限公司	2,319.05	1,489.17	64.21%
合计	47,949.09	30,097.94	62.77%
2019 年度/2019 年 12 月 31 日			
中国航空工业集团有限公司	24,646.82	24,256.40	98.42%
中国电子科技集团有限公司	6,921.82	6,701.73	96.82%
中国航天科工集团有限公司	3,862.80	3,720.17	96.31%
中国兵器装备集团有限公司	2,318.20	2,266.24	97.76%
中国电子信息产业集团有限公司	1,787.90	1,340.83	74.99%
合计	39,537.54	38,285.37	96.83%
2018 年度/2018 年 12 月 31 日			
中国航空工业集团有限公司	21,146.99	21,127.87	99.91%
中国电子科技集团有限公司	5,139.73	5,111.50	99.45%
中国航天科工集团有限公司	3,074.07	3,009.37	97.90%
陕西电子信息集团有限公司	1,883.18	1,883.01	99.99%
中国兵器工业集团有限公司	1,329.92	1,224.97	92.11%
合计	32,573.89	32,356.72	99.33%

截至 2021 年 8 月 31 日，发行人报告期各期末应收账款余额前五大集团期后回款金额分别为 32,356.72 万元、38,285.37 万元、30,097.94 万元和 20,313.38 万元，回款比例分别为 99.33%、96.83%、62.77% 和 26.93%。

发行人应收账款余额前五大客户均为大型高可靠产业集团，回款风险较低，回款周期相对较长，一般为 12 个月，且下半年回款比例较高。发行人 2018 年末、2019 年末的应收账款截至 2021 年 8 月 31 日的回款比例良好，2020 年末、2021

年6月30日的应收账款余额仍处于回款周期内。总体而言，发行人应收账款回款情况良好。

②应收票据

报告期各期末，发行人转入应收账款的应收票据情况如下所示：

单位：万元

项目	2021年 6月30日	2020年 12月31日	2019年 12月31日	2018年 12月31日
银行承兑汇票	-	2,000.00	-	-
商业承兑汇票	1,689.44	5,493.44	761.67	536.35
合计	1,689.44	7,493.44	761.67	536.35
应收票据账面价值	53,949.61	76,999.63	46,520.62	37,936.74
占比	3.13%	9.73%	1.64%	1.41%

发行人应收票据的出票人与背书人多为各高可靠产业集团，此类客户信用良好，且资金实力较强，履约能力强。报告期各期末，发行人逾期应收票据转入应收账款计量的金额及占比较小，占应收票据账面价值的比例分别为1.41%、1.64%、9.73%、3.13%。且2018-2020年末，发行人转入应收账款计量的应收票据全部于下期期初实现兑付，未出现逾期最终未兑付的情形。2020年末，发行人逾期应收票据转入应收账款计量的比例较2019年末有所增长，主要系发行人业务规模不断扩大所致，该7,493.44万元款项均已于2021年第一季度收回。2018年末、2019年末，发行人转入应收账款的逾期应收票据基本已于2019年第一季度、2020年第一季度实现兑付。

最近一期末，发行人转入应收账款的逾期应收票据金额为1,689.44万元，截至2021年8月31日，已有1,556.72万元商业承兑汇票已实现兑付，比例为92.14%。

(2) 发行人应收款项主要客户均为大型高可靠集团，回款风险低

发行人应收账款前五大客户的应收账款余额及占比情况如下所示：

单位：万元

项目	2021年 6月30日	2020年 12月31日	2019年 12月31日	2018年 12月31日
应收账款前五大客户	75,435.36	47,949.09	39,537.54	32,573.89
应收账款	110,421.47	70,738.96	56,306.30	43,596.26

项目	2021年 6月30日	2020年 12月31日	2019年 12月31日	2018年 12月31日
占比	68.32%	67.78%	70.22%	74.72%

报告期各期末，发行人应收账款余额前五大客户均为大型高可靠集团，应收账款余额合计占比分别为 74.72%、70.22%、67.78%、68.32%。

发行人应收票据前五大客户的应收票据余额及占比情况如下所示：

单位：万元

项目	2021年 6月30日	2020年 12月31日	2019年 12月31日	2018年 12月31日
应收票据前五大客户	40,873.51	60,883.92	39,219.17	32,702.33
应收票据	56,188.49	79,942.45	48,260.28	39,361.19
占比	72.74%	76.16%	81.27%	83.08%

报告期各期末，发行人应收票据余额前五大客户均为大型高可靠集团，其应收票据余额合计占比分别为 83.08%、81.27%、76.16%、72.74%。

综上所述，报告期各期末，发行人应收账款前五大客户、应收票据前五大客户均为大型高可靠集团，此类客户信用良好，资金实力较强，回款风险较低。

(二) 商业承兑汇票对应的主要客户情况包括但不限于客户名称、金额、合作时间、使用商业承兑汇票是否符合与主要客户的交易习惯，是否存在无法兑付风险，坏账准备计提是否充分合理

1、商业承兑汇票对应的主要客户情况包括但不限于客户名称、金额、合作时间、使用商业承兑汇票是否符合与主要客户的交易习惯

(1) 商业承兑汇票对应的主要客户情况包括但不限于客户名称、金额、合作时间

单位：万元

前五大集团名称	商业承兑汇票余额	合作时间
2021年6月30日		
中国航空工业集团有限公司	24,107.30	2002年起
中国电子科技集团有限公司	9,621.16	2005年起
中国航天科工集团有限公司	3,819.00	2003年起

前五大集团名称	商业承兑汇票余额	合作时间
中国航天科技集团有限公司	1,976.21	2010 年起
中国兵器装备集团有限公司	1,318.83	1998 年起
合计	40,842.51	-
2020 年 12 月 31 日		
中国航空工业集团有限公司	29,115.87	2002 年起
中国电子科技集团有限公司	12,979.25	2005 年起
中国航天科工集团有限公司	4,556.78	2003 年起
中国兵器装备集团有限公司	4,419.12	1998 年起
中国航天科技集团有限公司	4,143.96	2010 年起
合计	55,214.98	-
2019 年 12 月 31 日		
中国航空工业集团有限公司	21,540.94	2002 年起
中国电子科技集团有限公司	7,681.75	2005 年起
中国航天科工集团有限公司	2,439.99	2003 年起
中国兵器装备集团有限公司	1,795.25	1998 年起
中国航天科技集团有限公司	1,253.12	2010 年起
合计	34,711.05	-
2018 年 12 月 31 日		
中国航空工业集团有限公司	17,020.66	2002 年起
中国电子科技集团有限公司	5,833.19	2005 年起
中国航天科工集团有限公司	5,201.73	2003 年起
中国兵器工业集团有限公司	1,390.58	1998 年起
中国航天科技集团有限公司	964.68	2010 年起
合计	30,410.85	-

发行人商业承兑汇票前五大集团均为高可靠集团，报告期各期末，发行人商业承兑汇票前五大集团合计余额分别为 30,410.85 万元、34,711.05 万元、55,214.98 万元、40,842.51 万元，占商业承兑汇票余额比例分别为 85.40%、79.81%、75.05%、72.97%。

(2) 发行人主要客户的结算方式

发行人主要客户的结算方式详见本回复报告之“问题一”之“(一) 结合主

要客户销售结算模式、对应销售金额及应收款项、款项回收周期、同行业可比公司情况等补充说明应收款项占营业收入比重较高的原因及合理性，坏账准备计提是否充分，是否存在到期无法收回的风险”的相关分析，发行人使用商业承兑汇票符合与主要客户的交易习惯。

2、发行人商业承兑汇票是否存在无法兑付风险

发行人逾期商业承兑汇票转入应收账款情况及期后兑付情况详见本回复报告之“问题一”之“（一）结合主要客户销售结算模式、对应销售金额及应收款项、款项回收周期、同行业可比公司情况等补充说明应收款项占营业收入比重较高的原因及合理性，坏账准备计提是否充分，是否存在到期无法收回的风险”的相关分析，发行人商业承兑汇票无法兑付的风险较低。

3、发行人商业承兑汇票坏账准备计提是否充分合理

（1）发行人商业承兑汇票坏账准备计提情况

报告期各期末，发行人商业承兑汇票坏账准备计提情况如下表所示：

单位：万元

项目	2021年 6月30日	2020年 12月31日	2019年 12月31日	2018年 12月31日
账面余额	55,971.95	73,570.49	43,491.47	35,611.13
坏账准备	2,238.88	2,942.82	1,739.66	1,424.45
计提比例	4.00%	4.00%	4.00%	4.00%
账面价值	53,733.08	70,627.67	41,751.81	34,186.69

报告期各期末，发行人商业承兑汇票坏账计提金额分别为1,424.45万元、1,739.66万元、2,942.82万元、2,238.88万元，计提比例均为4%。

（2）发行人与同行业可比公司商业承兑汇票坏账准备计提比例对比情况

发行人与同行业可比公司商业承兑汇票坏账准备计提比例对比情况详见本回复报告之“问题一”之“（一）结合主要客户销售结算模式、对应销售金额及应收款项、款项回收周期、同行业可比公司情况等补充说明应收款项占营业收入比重较高的原因及合理性，坏账准备计提是否充分，是否存在到期无法收回的风险”的相关分析，发行人商业承兑汇票坏账计提比例与同行业上市公司对比无重

大差异，且相对谨慎。

（三）结合同行业可比公司情况、公司采购和销售模式等补充说明经营活动现金流量净额长期低于净利润水平的原因及合理性

1、同行业可比公司情况

报告期内，发行人净利润与经营活动产生的现金流量净额与同行业可比公司对比情况如下：

单位：万元

项目	宏达电子	振华科技	火炬电子	鸿远电子
2021年1-6月				
经营活动产生的现金流量净额	24,070.17	45,928.92	38,334.21	-1,702.21
净利润	43,296.37	51,800.75	56,379.08	45,439.33
经营活动产生的现金流量净额/净利润	0.56	0.89	0.68	-0.04
2020年度				
经营活动产生的现金流量净额	25,662.54	-6,923.91	2,542.94	15,317.56
净利润	52,918.67	60,249.83	63,059.38	48,606.87
经营活动产生的现金流量净额/净利润	0.48	-0.11	0.04	0.32
2019年度				
经营活动产生的现金流量净额	8,256.76	25,950.62	23,213.88	17,509.19
净利润	30,906.42	29,531.08	38,672.97	27,866.88
经营活动产生的现金流量净额/净利润	0.27	0.88	0.60	0.63
2018年度				
经营活动产生的现金流量净额	-3,818.06	31,813.13	13,289.01	5,263.66
净利润	21,898.10	30,393.84	33,573.57	21,836.27
经营活动产生的现金流量净额/净利润	-0.17	1.05	0.40	0.24

根据上表数据，除振华科技 2018 年经营活动产生的现金流量净额高于净利润外，发行人与同行业可比公司在报告期内均呈现经营活动现金流量净额不同程度地低于净利润的情况，其中发行人经营活动产生的现金流量净额占净利润比例呈逐年增加趋势，而可比公司该比例波动均较大。

2、发行人采购和销售模式

发行人以高可靠产品销售为主，而客户群体集中在国家高可靠产业集团，该类客户由于行业的特殊性，交货验收程序相对复杂，从公司发货至客户入库、以及客户货物入库至付款均需较长时间，同时客户通常选择用承兑汇票结算，而承兑汇票期限最长为 12 个月，因此发行人从销售到取得现金回款之间的周期很长。

发行人与主要材料供应商以及其他零件供应商物料货款结算方式主要为银行存款支付和商业汇票支付，从材料验收确认无误后至付款账期一般在 60 日以内。因此，发行人销售货物收款结算方式和采购付款结算方式及账期均存在差异。

3、净利润调节为经营活动现金流量情况

单位：万元

项目	2021 年 1-6 月	2020 年度	2019 年度	2018 年度
净利润	43,296.37	52,918.67	30,906.42	21,898.10
加：资产减值准备	967.10	2,883.22	2,484.31	2,841.60
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	2,663.32	5,176.02	3,902.52	2,837.46
无形资产摊销	99.98	95.72	27.92	28.2
长期待摊费用摊销	162.01	307.66	208.31	172.31
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	-0.54	-5.17	681.51	47.7
财务费用（收益以“-”号填列）	11.64	66.34	11.38	12.02
投资损失（收益以“-”号填列）	38.36	-189.07	-4,546.17	-266.09
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-297.54	-1,143.30	-166.17	-810.76
存货的减少（增加以“-”号填列）	-17,580.66	-23,293.85	-9,998.57	-8,357.64
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-11,659.87	-34,153.30	-22,471.46	-24,864.29
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	6,369.98	22,999.60	7,216.78	2,643.31
经营活动产生的现金流量净额	24,070.17	25,662.54	8,256.76	-3,818.06

发行人以自产高可靠电子元器件销售为主，客户群体集中在国家高可靠产业集团，而该类客户付款周期相对较长，且付款方式更多选择用商业汇票结算为主，因此发行人取得现金回款的周期较长，而供应商通常账期较短，公司面临一定的

资金周转压力；同时公司处于快速发展阶段，营收规模不断扩大，应收账款、应收票据及存货余额均逐年大幅增长，从而导致了经营活动产生的现金流量净额低于净利润水平。同行业可比公司均呈现相似情形，发行人经营活动现金流量净额低于净利润水平的情况与行业特征相符，具有合理性。

虽然发行人经营活动现金流量净额长期低于净利润水平，但报告期内经营活动现金流量净额占净利润比例逐年升高，且高可靠产品客户信用等级高，应收款项无法收回的可能性较小，因此相关风险较小。

二、补充披露内容

针对应收款项相关风险，发行人已在募集说明书之“重大事项提示”及“第六节 与本次发行相关的风险因素”之“四、税收及财务风险”补充披露内容如下：

“（一）应收账款及应收票据回收风险

报告期各期末，公司的应收账款分别为 40,200.00 万元、52,048.17 万元、65,881.80 万元和 **104,537.80 万元**，占总资产的比例分别为 23.94%、26.37%、22.24%和 **30.74%**，**应收账款坏账准备计提比例分别为 7.79%、7.56%、6.87%、5.33%**。公司的应收票据分别为 37,936.74 万元、46,520.62 万元、76,999.63 万元和 **53,949.61 万元**，占总资产的比例分别为 22.59%、23.57%、25.99%和 **15.86%**，**应收票据坏账准备计提比例在报告期各期均为 4.00%**。报告期内，随着公司营业收入的不断增长，应收账款和应收票据规模也不断增长，主要系公司主要客户为大型高可靠集团下属单位，付款周期相对较长所致，大额应收账款和应收票据影响公司资金回笼速度，给公司带来一定的资金压力。如果国际形势、国家安全环境发生变化，导致公司主要客户经营发生困难，进而不能按期付款，**将会导致公司出现应收账款及应收票据无法收回的风险。**

（二）商业承兑汇票无法兑付风险

报告期各期末，公司的商业承兑汇票账面余额分别为 35,611.13 万元、43,491.47 万元、73,570.49 万元和 55,971.95 万元，商业承兑汇票坏账准备计提金额分别为 1,424.45 万元、1,739.66 万元、2,942.82 万元、2,238.88 万元，计提比例均为 4%。发行人商业承兑汇票主要来自于大型高可靠集团，如果客户

经营发生困难，则可能出现商业承兑汇票无法兑付的风险。”

三、核查程序

保荐机构、会计师执行了如下核查程序：

1、获取发行人销售收入及应收款项明细表，了解发行人主要客户的销售结算模式及款项回款周期；

2、从公开市场中获取同行业可比公司财务报告，将同行业可比公司的应收款项占营业收入比重情况及收入构成情况与发行人进行比较，并分析差异原因；将同行业可比公司经营活动产生的现金流量净额与净利润水平与发行人进行比较；

3、获取发行人应收款项坏账准备计提明细表，了解发行人的坏账准备计提政策，并将发行人的坏账准备计提政策及计提比例与同行业可比公司进行对比；

4、获取发行人应收账款账龄明细表，分析发行人账龄情况；

5、获取发行人应收账款主要客户期后回款数据，分析发行人应收账款回款情况；获取发行人应收票据逾期转入应收账款明细及期后兑付情况，分析发行人应收票据兑付情况；

6、获取发行人商业承兑汇票明细，分析发行人商业承兑汇票对应的主要客户情况，包括客户名称、商业承兑汇票余额、合作时间等；

7、了解主要客户和供应商结算方式和付款期限，分析是否与发行人现金流情况一致；

8、获取发行人用间接法编制的现金流量表，检查经营活动现金流量净额低于净利润水平的原因。

四、核查意见

经核查，保荐机构、会计师认为：

1、发行人主要客户群体为国家高可靠产业集团，此类客户一般对付款条件及付款期限无特别约定，业务流程相对较长，且多以商业汇票形式回款，故而导致发行人应收款项余额较大，占营业收入比重较高。同时，发行人应收款项较同

行业其他上市公司占营业收入比例偏高,主要系产品结构及客户群体差异。因此,发行人应收款项占营业收入比重较高具备合理性。此外,发行人应收款项坏账准备计提比例充分,且坏账准备计提政策与比例与同行业可比公司基本一致;发行人应收款项回款情况良好,到期无法收回的风险较小;

2、发行人商业承兑汇票对应的主要客户均为长期合作的高可靠产业集团,使用商业承兑汇票符合交易习惯,无法兑付的风险较小,坏账准备计提充分合理;

3、发行人对高可靠客户取得现金回款的周期较长,而供应商通常账期较短,公司面临一定的资金周转压力;同时随公司营收规模不断扩大,应收账款、应收票据及存货余额均逐年大幅增长,从而导致了经营活动产生的现金流量净额低于净利润水平。同行业公司均呈现相似情形,发行人符合行业特征,具有合理性;

4、发行人已在募集说明书中补充披露上述问题所涉及的相关风险。

问题二

报告期各期末，发行人的存货账面价值分别为 26,048.82 万元、34,815.63 万元、57,318.58 万元和 74,214.46 万元，呈现持续上升趋势，报告期各期末存货周转次数为 0.90、0.84、0.87、0.62。截至 2021 年 6 月 30 日，发行人发出商品账面价值 35,434.99 万元，占存货比重 47.75%；库存商品账面价值 5,916.81 万元，对应存货跌价准备和合同履约成本减值准备 3,422.46 万元。

请发行人补充说明：（1）存货持续增长的原因及合理性，是否与收入规模相匹配，对比同行业可比公司情况，说明存货周转率持续较低的原因及合理性；（2）结合发出商品对应的主要客户及订单金额，发货及客户签收的具体程序和时间周期、发出商品在报告期后的收入确认及成本结转情况，说明报告期末发出商品占比较高的原因及合理性；（3）结合行业市场环境、库存商品分类明细及库龄情况、存货跌价准备计提和转销的计算过程、计提存货减值准备的产品期后销售情况、同行业可比公司情况，说明计提存货跌价准备的合理性和充分性，未来是否存在继续减值的风险。

请发行人补充披露（3）相关的风险。

请保荐人和会计师核查并发表明确意见。

回复：

一、对问题的回复

（一）存货持续增长的原因及合理性，是否与收入规模相匹配，对比同行业可比公司情况，说明存货周转率持续较低的原因及合理性

1、存货持续增长的原因及合理性，是否与收入规模相匹配

（1）存货持续增长的原因及合理性

报告期各期末，发行人存货的分类明细及增速情况如下表所示：

单位：万元

项目	2021年6月30日		2020年12月31日		2019年12月31日		2018年12月31日	
	金额	增速	金额	增速	金额	增速	金额	增速
原材料	25,200.08	52.24%	16,552.75	69.55%	9,762.92	20.81%	8,081.36	72.72%
在产品	8,233.83	6.75%	7,713.49	44.96%	5,321.18	22.74%	4,335.44	38.91%
库存商品	5,916.81	-15.20%	6,977.36	-10.96%	7,836.13	-3.72%	8,138.76	25.68%
发出商品	34,863.74	33.71%	26,074.98	119.20%	11,895.40	116.54%	5,493.27	34.94%
合计	74,214.46	29.48%	57,318.58	64.63%	34,815.63	33.66%	26,048.82	41.98%

发行人的存货主要包括原材料、在产品、库存商品和发出商品。报告期各期末，发行人的存货账面价值分别为26,048.82万元、34,815.63万元、57,318.58万元和74,214.46万元，占流动资产的比例分别为18.40%、20.71%、24.60%和27.94%。

由上表可见，报告期各期末，发行人存货账面价值不断增长，主要是由于发出商品、原材料不断增长所致。主要原因包括：

①报告期内，发行人业务规模不断扩大，销售订单逐年增加，收入持续增长，存货规模也随之增长。

②发行人主要客户为大型高可靠集团，由于高可靠客户行业的特殊性，高可靠装备制造产业链很长，涉及高可靠单位、整机厂、系统级供应商、模块级供应商以及其他零件供应商等不同层次的参与方，各个层次厂商间的交货验收程序也相对更为严格和复杂，高可靠企业在签收货物后的检验时间较长，导致发行人发出商品规模较大，且随着发行人销售规模不断扩大，发出商品规模也随之增加。

③发行人主要原材料包括钽粉、钽外壳、钽盖、集成电路等。钽粉系各类型钽电容器的主要原材料之一，采购周期长、起订量大、验证周期长。发行人为了保证生产、提高采购效率、降低采购成本、节省验证次数和周期、确保钽粉的一致性，单次采购量普遍较大。随着发行人业务规模不断扩大，发行人钽粉的备货规模不断增长，钽外壳、钽盖、集成电路等原材料的采购规模也不断增长，使得发行人原材料规模不断增加。

综上，发行人存货规模随着发行人业务规模不断扩大而增长，具备合理性。

(2) 存货是否与收入规模相匹配

报告期各期末，发行人存货与营业收入的匹配情况如下表所示：

单位：万元

项目	2021年1-6月/ 2021年6月30日	2020年度/ 2020年12月31日	2019年度/ 2019年12月31日	2018年度/ 2018年12月31日
存货账面价值	74,214.46	57,318.58	34,815.63	26,048.82
营业收入	92,269.95	140,085.76	84,404.17	63,631.46
存货账面价值占 营业收入的比例	80.43%	40.92%	41.25%	40.94%

注：在计算2021年6月30日存货账面价值占营业收入的比例时，营业收入未采用年化方式。

报告期各期末，发行人的存货账面价值分别为26,048.82万元、34,815.63万元、57,318.58万元和74,214.46万元，占营业收入的比例分别为40.94%、41.25%、40.92%和80.43%。发行人存货与收入规模具有匹配性。

2、对比同行业可比公司情况，说明存货周转率持续较低的原因及合理性

报告期内，发行人与同行业可比公司存货周转率对比情况如下：

公司名称	证券代码	2021年1-6月	2020年度	2019年度	2018年度
振华科技	000733.SZ	0.93	1.65	1.59	2.69
火炬电子	603678.SH	1.45	2.81	2.57	2.71
鸿远电子	603267.SH	2.12	3.95	2.48	2.70
平均值		1.50	2.80	2.22	2.70
中位值		1.45	2.81	2.48	2.70
发行人	300726.SZ	0.39	0.87	0.84	0.90

注：2021年1-6月存货周转率未年化。

报告期内，发行人存货周转率低于可比公司，主要原因如下：

(1) 发行人以高可靠产品销售为主，而客户群体集中在国家高可靠产业集团，该类客户由于行业的特殊性，交货验收程序相对复杂，从公司发货至客户入库时间相对较长；同时由于高可靠客户定制的产品型号与规格较多，公司考虑到产品具有较长保存期限的特点，通常会在满足订单需求量的基础上额外生产一些产品，作为存货以备客户调用。

(2) 业务模式、收入确认方式和主要产品结构存在差异。报告期内，火炬电子代理业务收入占营业收入比例分别为70.19%、67.79%、67.61%和64.15%，

鸿远电子代理业务收入占营业收入比例分别为46.82%、43.82%、47.53%和39.35%，代理业务的周转速度通常较快，使得火炬电子和鸿远电子存货周转率较高。根据振华科技2019年年报披露的收入确认方法，其存在客户验收时确认收入和移交给客户时确认收入两种方式，移交即确认收入的方式使得存货周转率升高；而发行人以到货验收完成时点确认收入，由于高可靠产品销售收入为发行人营业收入的主要组成部分，且高可靠领域客户验收周期相对较长，从而导致发行人存货周转率相对较低。

综上，发行人存货周转率较低符合其业务特征及行业特性，具有合理性。

(二) 结合发出商品对应的主要客户及订单金额，发货及客户签收的具体程序和时间周期、发出商品在报告期后的收入确认及成本结转情况，说明报告期末发出商品占比较高的原因及合理性

1、发出商品对应的主要客户及订单金额

截至2021年6月30日，发行人发出商品前五大客户的发出商品余额及对应的订单金额如下所示：

单位：万元

集团名称	发出商品余额	订单金额
中国电子科技集团有限公司	6,464.05	22,099.46
中国航天科技集团有限公司	5,371.55	16,158.16
中国航空工业集团有限公司	4,915.33	21,142.08
中国航天科工集团有限公司	3,433.59	8,799.62
中国兵器装备集团有限公司	2,347.78	7,282.86
合计	22,532.29	75,482.18

截至2021年6月30日，发行人发出商品余额前五大客户均为大型高可靠集团，其发出商品余额合计为22,532.29万元，占最近一期末发出商品余额的比例为63.59%。发行人最新一期末发出商品余额前五大客户的订单金额能覆盖发出商品余额。

2、发货及客户签收的具体程序和时间周期

发行人根据客户订单要求按期完成生产，经质检合格完成审核后放行，并通

过物流公司发送至客户公司，客户签收后进入验收阶段。发行人客户主要为大型高可靠集团及其下属关联公司，高可靠行业制造产业链较长，涉及整机厂、系统级供应商、模块级供应商以及其他零件供应商等不同层次的参与方，各个层次厂商间的交货验收程序也相对更为严格和复杂，因此客户验收周期较长，从而导致发行人发出商品金额较大，占存货总额的比例较高。

3、发出商品在报告期后的收入确认及成本结转情况

发行人报告期各期末发出商品余额截至 2021 年 8 月 31 日所确认的收入和结转的成本金额如下表所示：

单位：万元

截止日	发出商品余额	确认收入金额	结转成本金额	结转比例
2021 年 6 月 30 日	35,434.99	38,868.25	11,065.79	31.23%
2020 年 12 月 31 日	26,351.36	57,060.57	19,417.71	73.69%
2019 年 12 月 31 日	12,025.81	33,909.21	10,419.92	86.65%
2018 年 12 月 31 日	5,493.27	17,798.18	4,728.40	86.08%

发行人报告期各期末发出商品余额截至 2021 年 8 月 31 日的成本结转比例分别为 86.08%、86.65%、73.69%、31.23%。

综上，发行人发出商品占比较高具备合理性。

（三）结合行业市场环境、库存商品分类明细及库龄情况、存货跌价准备计提和转销的计算过程、计提存货减值准备的产品期后销售情况、同行业可比公司情况，说明计提存货跌价准备的合理性和充分性，未来是否存在继续减值的风险

1、行业市场环境

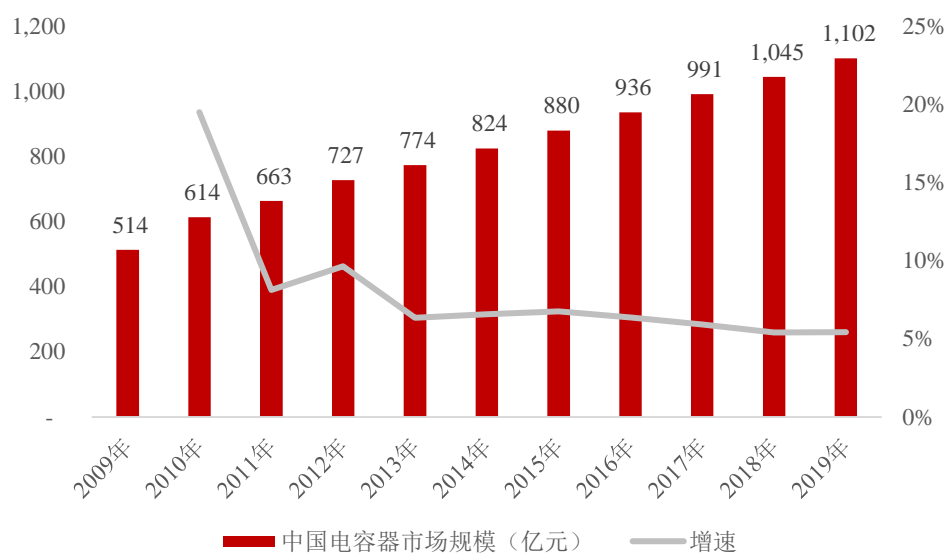
（1）电容器行业

电容器最常用的电子元器件之一，在高可靠领域和民用领域应用广泛。作为主要的电子元件之一，电容器产量约占整个电子元件的 40%。近年来，随着信息技术和电子设备的快速发展及国际制造业向中国转移，电容器需求呈现出整体上升态势，我国电容器产业也快速发展成为世界电容器生产大国和出口大国。根据

产业信息网数据，我国电子元器件行业总产值约占电子信息产业的五分之一，电子元器件产业已成为支撑我国电子信息产业发展的重要基础。

根据中国电子元件行业协会电容器分会数据统计，2019 年中国电容器市场规模达 1,102 亿元，较 2018 年同比增长 5.43%，中国电容器市场规模增速高于全球整体水平。

2009-2019 年中国电容器市场规模及增速

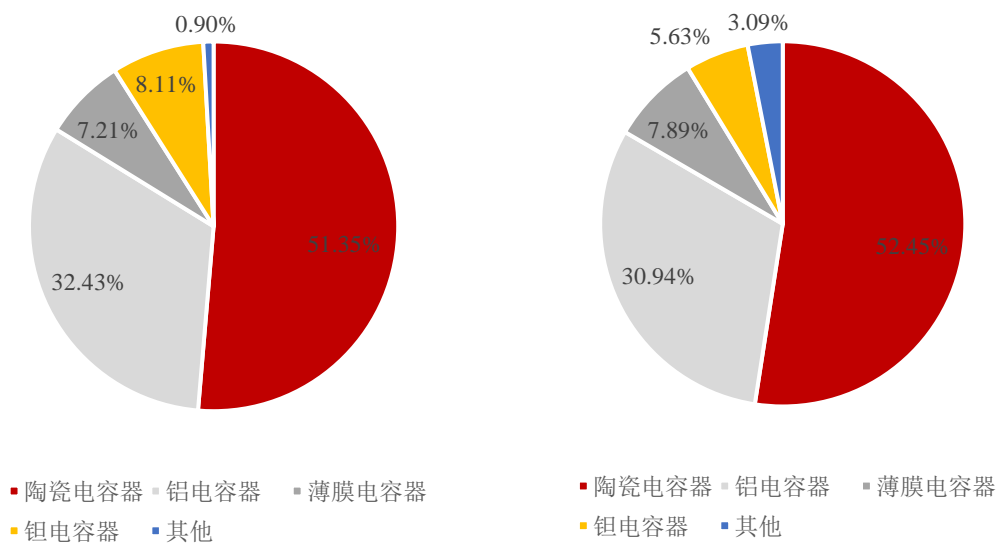


资料来源：中国电子元件行业协会电容器分会

在电容器行业中，陶瓷电容器、铝电容器、钽电容器和薄膜电容器等四大类电容器占据了 95% 以上的市场份额，2019 年主要电容器市场占比如下：

2019 年全球电容器市场产品结构

2019 年中国电容器市场产品结构



资料来源：中国电子元件行业协会电容器分会

由于钽电容拥有高能量密度、高可靠性、稳定的电性能、较宽的工作温度范围，在工业市场、高可靠市场都得到了非常广泛的应用。钽电容器的可靠性高、漏电流小、性能稳定、具有极高的电场强度，因此特别适宜于容量密度大要求的场合，具有铝电容、薄膜电容、陶瓷电容无可替代的优势。虽然因为其成本较高导致市场份额小于其他三类电容器，但在高端电容器的领域，钽电容器拥有稳定的市场份额和性能优势。

发行人钽电容器主要应用于高可靠领域。高可靠钽电容器由于涉及到政府和国家安全问题，审批较为严格，进入市场的周期较长、资金成本高，所以国内拥有相关资质的钽电容器生产厂商所占有的市场份额保持相对稳定，宏达电子、振华科技等少数企业占据主要的市场份额。

发行人部分钽电容器也应用于民品领域。根据海关总署信息统计，2019年中国进口片式钽电容 36.43 亿元，占到钽电容市场的 59%，进口依赖程度较高。考虑到以美国为首的西方国家正逐步收紧对中国进口高端电子元器件的限制，未来民品市场钽电容国产化率有望提高，国产替代市场空间较大。

（2）陶瓷电容器行业

陶瓷电容器可以分为片式多层陶瓷电容器（MLCC）、单层陶瓷电容器（SLC）及引线式多层陶瓷电容器，由于多层陶瓷电容器（MLCC）具有低 ESR，耐高压、

高温，体积小、电容量范围宽等特点，它被广泛应用于包括各种高可靠、民用电子整机中的振荡、耦合、滤波、旁路电路中，其市场规模约占整个陶瓷电容器的93%。

近年来，陶瓷电容器下游应用需求持续增长，其中增长最快的三个应用领域是消费电子领域、汽车电子领域、通信领域：

随着消费电子产品功能需求的不断升级，以智能音频设备、智能手机、个人电脑为代表的消费电子产品持续保持较高规模的市场需求。以智能手机为例，随着硬件性能的提升和通信标准的提升，智能手机领域对于陶瓷电容器的需求不断增长。伴随智能手机、平板电脑市场的不断扩容、制造组装产业向中国大陆转移，国内陶瓷电容器市场需求将会继续上升，国内电子元件市场将会进一步扩大。

汽车行业对陶瓷电容器需求增长主要来自汽车电子化水平的提升以及新能源汽车对电容器需求量的显著提升。汽车的电动化和智能化将大大提高单位汽车的陶瓷电容器使用量，以及高规格陶瓷电容器的使用比例。

全球通信行业的发展将扩大陶瓷电容器市场体量。作为下一代移动通信技术，5G 技术将在全球范围内迎来高速发展，从而带动通信行业的发展。通信设备中通常会用到 MLCC、单层陶瓷电容器和薄膜电容器，5G 的发展也将使陶瓷电容器需求量有相当程度的增加。

（3）微电路模块行业

微电路模块是由微电路和分立元件形成的互连组合，能够实现一种或多种电子线路功能。微电路模块具体包括电源微电路模块、惯性微电路模块、微波组件等，根据产品功能能够被广泛应用于通信、航空、航天、导航、船舶、铁路、电力、工控等领域。

我国模块电源市场厂商众多，国内本土企业多为中小型企业，行业集中度较低，市场竞争格局分散，由于我国模块电源企业的发展处于初期阶段，早年间市场主要被国际品牌占据。近年来下游网络通讯及高可靠领域的快速发展，带动了对模块电源的需求，从而也促进了国产品牌的发展，以中小功率模块电源为代表的市场正在快速被国产品牌所替代，国产品牌市场份额逐渐提升。

综上，发行人主要产品所处的电容器行业、陶瓷电容器行业、微电路模块行

业下游应用领域均十分广泛，且信息技术和电子设备的快速发展及国际制造业向中国转移、5G 技术的推广、国产化替代进程的加速等因素提供了较大的市场规模增长空间，发行人主要产品所处行业市场环境良好，下游需求空间广阔。

2、库存商品分类明细及库龄情况

(1) 库存商品分类明细

报告期各期末，发行人库存商品分类明细如下所示：

单位：万元

产品类别	2021年1-6月		2020年度		2019年度		2018年度	
	余额	占比	余额	占比	余额	占比	余额	占比
非固体电解质钽电容器	2,488.14	26.64%	2,557.12	25.13%	2,525.08	23.68%	2,117.66	21.06%
固体电解质钽电容器	2,595.76	27.79%	3,898.11	38.31%	4,531.92	42.50%	3,272.49	32.54%
微电路模块	922.74	9.88%	566.14	5.56%	424.84	3.98%	1,687.52	16.78%
陶瓷电容器	1,109.37	11.88%	680.65	6.69%	572.43	5.37%	372.21	3.70%
其他产品	2,223.27	23.81%	2,472.35	24.30%	2,609.85	24.47%	2,607.40	25.93%
合计	9,339.28	100.00%	10,174.36	100.00%	10,664.11	100.00%	10,057.27	100.00%

从库存商品账面余额分类明细来看，发行人库存商品主要由非固体电解质钽电容器、固体电解质钽电容器、微电路模块、陶瓷电容器构成，其中非固体电解质钽电容器、固体电解质钽电容器合计占比分别为 53.59%、66.18%、63.45%、54.44%。发行人库存商品分类明细与发行人营业收入结构基本匹配。

(2) 库存商品库龄情况

报告期各期末，发行人库存商品库龄情况如下所示：

单位：万元

库龄	2021年1-6月		2020年度		2019年度		2018年度	
	余额	占比	余额	占比	余额	占比	余额	占比
1年以内	4,822.80	51.64%	4,425.39	43.50%	4,188.33	39.28%	5,290.98	52.61%
1至2年	1,480.34	15.85%	1,920.00	18.87%	1,773.78	16.63%	1,146.85	11.40%
2至3年	884.97	9.48%	1,018.20	10.01%	1,027.64	9.64%	1,175.21	11.69%
3至4年	515.58	5.52%	680.41	6.69%	1,167.29	10.95%	833.17	8.28%
4至5年	464.33	4.97%	741.11	7.28%	883.17	8.28%	595.22	5.92%

库龄	2021年1-6月		2020年度		2019年度		2018年度	
	余额	占比	余额	占比	余额	占比	余额	占比
5年以上	1,171.25	12.54%	1,389.25	13.65%	1,623.91	15.23%	1,015.83	10.10%
合计	9,339.28	100.00%	10,174.36	100.00%	10,664.11	100.00%	10,057.27	100.00%

报告期各期末，发行人库龄在一年以上的库存商品占比分别为 47.39%、60.73%、56.50%、48.36%。发行人库龄在一年以上的库存商品主要为高可靠客户产品备货。发行人客户主要为高可靠产业集团及其下属关联公司，定制的产品型号与规格较多，发行人考虑到产品具有较长保存期限的特点且定制化产品合格率波动较大，常在一批次产品生产过程中多生产一定比例，生产的产品在满足订单的需要之后，将其作为存货以备客户调用。

3、存货跌价准备计提和转销的计算过程

(1) 发行人存货跌价准备计提的会计政策

发行人资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量，存货成本高于其可变现净值的，计提存货跌价准备，计入当期损益。

报告期各期末，发行人会对存货进行盘点，在盘点过程中重点关注存货的库龄、品质状态、存货移动等情况，并以此汇总情况判断存货是否出现减值迹象。

发行人各期计提的存货跌价准备主要为原材料和库存商品等。不同类别存货可变现净值的依据如下：为生产而持有的材料等，用其生产的产成品的可变现净值高于成本的，该材料仍然按照成本计量；为备货持有的材料，结合行业实际和经验，发行人制定了合理的跌价准备计提原则。为执行销售合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算。持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。

(2) 存货跌价准备和转销的具体计算过程

发行人存货跌价准备和转销的具体计算过程如下：

①需要经过加工的原材料和在产品，在正常生产经营过程中，应当以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值。可变现净值与该产品的成本逐一进行比较，成

本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。

发行人的原材料大部分用作生产销售，其最终产品主要为高可靠单位产品，综合毛利率较高，原材料减值测试参考在产品减值测试过程。由于产品规格型号较多，发行人原材料同样存在较多规格，存在由于市场需求下降造成可变现净值下降的风险，出于谨慎性原则，发行人对于原材料库龄较长且无变动的原材料并结合原材料的品质、等级等情况按照库存成本与最新市场报价比较确定减值准备计提金额。对于因保管不善、闲置等原因而出现损毁、变质的少部分原材料，全额计提减值准备。

②库存商品、发出商品和用于出售的材料等商品类存货，在正常生产经营过程中以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值，可变现净值与该存货的库存成本逐一进行比较，成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。

为执行销售合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为估计售价计算。持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以最新销售价格为估计售价计算。基于谨慎性原则，公司对库龄3年以上且长期无变动的产品进行全额计提减值准备。

③以前计提存货跌价准备的影响因素已经消失的，将减记金额在原已计提的跌价金额内转回，计入当期损益，以前计提存货跌价准备的存货对外销售的，将对应的存货跌价准备金额进行转销，冲减当期营业成本。

(3) 发行人存货跌价准备计提情况

按照以上计算过程，报告期各期末，公司的存货跌价准备计提情况如下：

单位：万元

项目	2021年 6月30日	2020年 12月31日	2019年 12月31日	2018年 12月31日
存货跌价准备金额	4,951.05	4,266.28	3,475.38	2,243.61
存货账面余额	79,165.51	61,584.86	38,291.01	28,292.43
计提比例	6.25%	6.93%	9.08%	7.93%

报告期各期末，发行人存货跌价准备计提比例分别为7.93%、9.08%、6.93%、

6.25%。

4、计提存货减值准备的产品期后销售情况

发行人的部分产品定制化程度较高，且高可靠领域客户对产品交付周期要求较为严格，因此，发行人一般会略多于订单数量进行生产，以快速响应客户的增补需求。若客户后续不存在增补需求，则会导致该类存货库龄较长，未来销售存在较大不确定性，发行人基于谨慎性原则对该类存货的产品计提全额减值。

报告期内，发行人已计提减值的存货期后暂未实现销售。

5、同行业可比公司

发行人及可比公司报告期各期末存货跌价准备计提比例如下表所示：

公司名称	2021年6月30日	2020年12月31日	2019年12月31日	2018年12月31日
火炬电子	6.54%	6.79%	5.99%	6.34%
振华科技	6.91%	8.04%	8.21%	7.43%
鸿远电子	9.52%	10.17%	8.43%	12.05%
均值	7.66%	8.33%	7.54%	8.61%
发行人	6.25%	6.93%	9.08%	7.93%

如上表所示，发行人存货跌价准备计提比例与同行业可比公司不存在较大差异。

发行人及可比公司报告期各期末库存商品的跌价准备计提比例如下表所示：

公司名称	2021年6月30日	2020年12月31日	2019年12月31日	2018年12月31日
火炬电子	8.80%	10.11%	7.93%	7.71%
振华科技	16.11%	16.45%	15.32%	12.31%
鸿远电子	14.11%	18.98%	15.65%	17.95%
均值	13.01%	15.18%	12.97%	12.66%
发行人	36.65%	31.42%	26.52%	19.08%

发行人库存商品跌价准备计提比例与同行业平均水平相比更为审慎，存货跌价准备计提充分。

综上，发行人存货跌价准备计提具备合理性和充分性。

二、补充披露内容

针对存货相关风险，发行人已在募集说明书之“重大事项提示”及“第六节与本次发行相关的风险因素”之“四、税收及财务风险”补充披露内容如下：

“（三）存货规模增长及存货减值的风险

报告期内，公司业务规模持续增长，导致存货增长较快。公司的存货主要由原材料、在产品、库存商品和发出商品组成。报告期各期末，公司的存货账面价值分别为 26,048.82 万元、34,815.63 万元、57,318.58 万元和 74,214.46 万元，占流动资产比例分别为 18.40%、20.71%、24.60%和 27.94%。公司存货规模较大，一定程度上占用了公司资金而影响流动性。较高的存货规模仍可能导致计提较大金额的存货跌价准备，进而影响公司的利润水平。报告期各期末，公司分别计提存货跌价准备 2,243.61 万元、3,475.38 万元、4,266.28 万元及 4,951.05 万元。库存量能够保障生产经营的稳定性，但如果原材料、库存商品的行情出现大幅下滑或者公司产品销售不畅、发出商品未能得客户及时验收，而公司未能及时有效应对并做出相应调整，公司将面临存货减值的风险，进而会给公司经营造成一定的不利影响。”

三、核查程序

保荐机构、会计师执行了如下核查程序：

1、获取发行人存货明细表，结合发行人的采购模式、销售模式及营业收入增长情况对发行人存货增长的原因及合理性进行分析，并对发行人存货与营业收入的匹配情况进行分析；

2、从公开市场中获取同行业可比公司财务报告，将同行业可比公司存货周转率与发行人进行比较，分析差异原因；并对比分析发行人与同行业可比公司存货跌价准备计提情况，分析是否存在差异；

3、了解发行人的生产模式及与主要客户的销售确认模式，分析该模式对存货周转率的影响；

4、获取发行人发出商品对应的主要客户及订单金额明细，了解发行人发货

及客户签收的具体程序和时间周期,获取发行人发出商品在报告期后的收入确认及成本结转数据,分析报告期末发出商品占比较高的原因及合理性;

5、从公开市场获取发行人所处行业市场环境的信息,分析发行人主要产品下游应用领域情况及市场规模情况;

6、获取发行人库存商品分类明细及库存商品库龄情况,分析发行人库存商品结构及长库龄库存商品比例,分析发行人计提存货跌价准备的合理性和充分性;

7、了解发行人存货跌价准备计提和转销的计算过程、计提存货减值准备的产品期后销售情况,分析发行人计提存货跌价准备的合理性和充分性。

四、核查意见

经核查,保荐机构、会计师认为:

1、发行人高可靠客户具有行业特殊性,交货验收流程相对较长,导致发出商品规模较大;同时,报告期内发行人业务规模逐渐扩大,导致发出商品余额持续增加。此外,发行人主要原材料的采购及备货规模不断增长,使得发行人原材料余额不断增加。综上,发行人存货增长具备合理性,与收入规模相匹配;

2、发行人高可靠客户具有行业特殊性,交货验收流程相对较长,并且发行人在满足客户订单需求基础上会额外生产一些产品,作为存货以备客户调用。此外,同行业可比公司中火炬电子和鸿远电子均存在较大比例的代理业务,该类业务存货周转速度较快,导致存货周转率高于发行人。综上,发行人存货周转率较低具有合理性;

3、截至报告期末,发行人发出商品余额前五大客户的订单金额能覆盖发出商品余额。发行人高可靠客户具有行业特殊性,交货验收流程相对较长,导致发行人发出商品金额较大,占存货总额的比例较高。发行人发出商品期后确认收入和成本结转情况良好。综上,发行人发出商品期末占比较高具备合理性;

4、发行人主要产品所处行业下游应用领域广阔,市场规模大。发行人库存商品分类明细与发行人营业收入结构基本匹配,库龄在一年以上的库存商品主要为高可靠客户产品备货。发行人与同行业可比公司存货跌价准备计提比例不存在重大差异。综上,发行人存货跌价准备充分;

5、发行人已在募集说明书中补充披露上述问题所涉及的相关风险。

问题三

申请文件显示，发行人控股股东、实际控制人及其控制的其他企业均未从事与发行人相同或相似业务。发行人实际控制人控制的青岛艾森达新材料科技有限公司（以下简称“青岛艾森达”）、深圳市同达鑫电路科技有限公司、湖南同达鑫电子科技有限公司经营范围内存在与发行人近似业务，同时发行人与艾森达等关联方在报告期内发生关联采购和关联销售情形，2020年发行人发生关联采购金额798.91万元、关联销售金额4,230.48万元。

请发行人补充说明：（1）结合报告期内关联交易采购和销售的内容、定价依据，说明本次募投项目实施后是否会新增关联交易，如是，请说明关联交易的定价是否公允，关联交易对应的收入、成本费用或利润总额占发行人相应指标的比例，是否会新增显失公平的关联交易，是否严重影响公司生产经营的独立性；（2）说明发行人控股股东、实际控制人及其控制的其他企业资产具体情况，与发行人在业务、资产、技术、产品等方面的区别与联系，实施募投项目是否新增重大不利影响同业竞争情形，以及未来避免同业竞争的措施及其有效性。

请发行人补充披露（1）（2）相关的风险。

请保荐人核查并发表明确意见，请会计师核查（1）并发表明确意见，请发行人律师核查（2）并发表明确意见。

回复：

一、对问题的回复

（一）结合报告期内关联交易采购和销售的内容、定价依据，说明本次募投项目实施后是否会新增关联交易，如是，请说明关联交易的定价是否公允，关联交易对应的收入、成本费用或利润总额占发行人相应指标的比例，是否会新增显失公平的关联交易，是否严重影响公司生产经营的独立性

报告期内，发行人关联采购和销售的内容及定价依据情况如下：

关联交易类型	关联方	交易内容	定价依据
采购商品和接受劳务	宁夏艾森达	HTCC多层基板、氮化铝粉、转接头等材料	参照市场公允价格双方协商确定
	银川艾森达	单抛氮化铝基板、双抛氮化	参照市场公允价格双方协

关联交易类型	关联方	交易内容	定价依据
		铝基板、研磨氧化铝基板等材料	商确定
	宏讯微电子	T/R 组件、功率放大器、开关矩阵等芯片产品	参照市场公允价格双方协商确定
	湘东化工	烧结炉及配件	参照市场公允价格双方协商确定
	展芯半导体	集成电路模块	参照市场公允价格双方协商确定
销售商品和提供劳务	宁夏艾森达	高纯氮气纯化器、设备配件	参照市场公允价格双方协商确定
	银川艾森达	氮化硼板、氮化硼框、氧化铝、坩埚边条等	参照市场公允价格双方协商确定
	宏讯微电子	微电模块、电源模块、耦合器等	参照市场公允价格双方协商确定
	湘东化工	赤道板、不锈钢板、喷氧管、换热管等材料	参照市场公允价格双方协商确定

如上表所示，报告期内，发行人关联销售和关联采购的内容与本次募投项目的陶瓷电容器、环形器及隔离器等产品无关，本次募投项目实施后，不会新增关联交易。

(二) 说明发行人控股股东、实际控制人及其控制的其他企业资产具体情况，与发行人在业务、资产、技术、产品等方面的区别与联系，实施募投项目是否新增重大不利影响同业竞争情形，以及未来避免同业竞争的措施及其有效性

1、发行人控股股东、实际控制人控制的其他企业具体情况，以及与发行人在业务、资产、技术、产品等方面的区别与联系

(1) 发行人主营业务和主要产品

发行人主营业务为高可靠电子元器件和电路模块的研发、生产、销售及相关服务，主要产品包括钽电容器、陶瓷电容器、微电路模块和其他电子元器件等。

(2) 发行人控股股东、实际控制人控制的其他企业的基本情况、主营业务、和主要产品

发行人控股股东、实际控制人控制的其他企业的基本情况、主营业务、和主要产品情况如下：

序号	企业名称	成立时间	经营范围	主营业务	主要产品
1	株洲特焊	1998年10月21日	焊接材料制造；电焊条制造；焊丝制造；冷作、机械零部件加工；水轮机修理；电焊机制造、销售、维修。出口本企业自产特种电焊条(国家组织统一联合经营的出口商品除外)；进口本企业生产科研所需原辅材料、机械设备、仪器仪表及零配件（国家实行核定公司经营的进口商品除外）；经营本企业的进料加工和“三来一补”业务；普通货运；房屋租赁	碳钢焊条、不锈钢焊条、堆焊焊条、铸铁焊条、埋弧焊丝的研发、生产和销售	碳钢焊条，不锈钢焊条，堆焊焊条，铸铁焊条，埋弧焊丝
2	湘东化工	1980年10月30日	炼油设备、化工设备（含球罐）、环保设备、罐车、汽轮机、泵、煤气发生炉、压力容器及配件、铸锻件、工具、模具、刀具、工业气体制造销售；工厂生产设施、设备的施工与安装；罐车、压力容器（含钢瓶、无缝气瓶）、化工机械、燃气具检修；压力容器、罐车设计；金属表面及热处理；新型专利产品、新材料开发；化工机械技术咨询、信息服务；餐饮、住宿服务；劳动保护用品、计衡量器具、橡胶制品、工业用阀门、通用设备零部件、建材、电石、电焊条、液化气销售；资产租赁；进出口业务	压力容器、球罐、汽轮机的研发、生产和销售	压力容器(包括合成塔、换热器、塔器、储存容器、球形储罐、干燥釜、高温高压反应釜)
3	株洲湘宏房地产开发有限公司	2013年3月6日	房地产开发经营	房地产开发经营	住宅、房产
4	湖南湘化机汽轮机有限公司	2015年1月6日	汽轮机研发、设计、制造销售，炼油、化工生产专用设备、机械零配件及仪器仪表、压力容器及配件、铸锻件、工具、模具、刀具制造销售，工厂生产设施、设备的施工与安装，金属表面及热处理，金属制品、机械和设备修理，新产品、新材料研发，化工机械技术信息咨询，餐饮、住宿服务，劳动保护用品、计衡量器具、橡胶制品、金属材料、电器设备、工业用阀门、通用设备零部件、建材、电石、电焊条销售，自有商业房屋租赁服务，进出口业务	汽轮机研发、设计、制造、销售	凝气式、背压式、抽汽式、湿蒸汽、快装组合式、立式汽轮机

序号	企业名称	成立时间	经营范围	主营业务	主要产品
5	青岛艾森达	2012年12月10日	无实际经营业务	无实际经营业务	无实际经营业务
6	深圳市同达鑫电路科技有限公司	2007年12月3日	一般经营项目是：集成电路载板和框架及封装材料、电子专用材料、印制电路板、半导体器件、电子元器件、机电组件设备、陶瓷电子元件研发和销售；金属表面处理及热加工处理；电子电路设计服务、高性能集成电路的技术咨询、转让及应用；汽车电子，汽车美容产品的技术开发与销售；国内贸易，货物及技术进出口。许可经营项目是：集成电路载板和框架及封装材料、电子专用材料、印制电路板、半导体器件、电子元器件、机电组件设备、陶瓷电子元件研生产	陶瓷基板制造、研发和生产	封装陶瓷基板（通讯用基板、汽车用LED基板、UVC LED基板、白光LED封装基板）
7	湖南同达鑫电子科技有限公司	2021年4月28日	电力电子元器件制造；集成电路设计制造；电子专用材料制造；电子电路制造；半导体分立器件制造；金属表面处理及热加工处理；新材料技术推广服务；汽车电子、美容产品的技术开发与销售；贸易代理服务；货物及技术进出口业务（国家禁止或限制的进出口业务除外）	陶瓷基板制造、研发和生产	封装陶瓷基板（通讯用基板、汽车用LED基板、UVC LED基板、白光LED封装基板）
8	湖南聚银汇新材料科技有限公司	2021年8月3日	新材料技术推广服务；电子专用材料研发、制造、销售；金属材料制造、销售	电子浆料研发、制造、销售	导电银浆
9	东莞安智芯半导体科技有限公司	2020年5月20日	一般项目：电子元器件制造；电子元器件批发；电子专用材料研发；电子元器件零售；光电子器件制造；光电子器件销售；集成电路芯片设计及服务；集成电路芯片及产品制造；信息技术咨询服务；集成电路设计；集成电路芯片及产品销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；非居住房地产租赁	光通讯传感器、LED电子制造、销售	T046-光纤、T056-基站发射器、温度传感器、传感器、Sensor-幻彩灯珠、LED-车载照明

如上表所示，除深圳市同达鑫电路科技有限公司、湖南同达鑫电子科技有限公司、湖南聚银汇新材料科技有限公司以及东莞安智芯半导体科技有限公司外，发行人控股股东、实际控制人控制的其他企业在主营业务、主要产品等方面同发行人存在较大差异，不存在同业竞争的情形；深圳市同达鑫电路科技有限公司、湖南同达鑫电子科技有限公司、湖南聚银汇新材料科技有限公司以及东莞安智芯半导体科技有限公司的经营范围包含电子电路、集成电路、电子专用材料研发、制造、销售，与发行人经营范围存在部分重叠，但主营业务、主要产品等方面存在较大差异。截至本回复报告签署日，上述企业不存在从事与发行人主营业务相同或相似的业务，与发行人在业务、资产、财务、机构、人员等方面相互独立，与发行人不构成同业竞争，具体情况如下：

①业务独立

报告期内，发行人控股股东、实际控制人控制的企业深圳市同达鑫电路科技有限公司、湖南同达鑫电子科技有限公司、湖南聚银汇新材料科技有限公司以及东莞安智芯半导体科技有限公司虽包含有上述与电子电路、集成电路、电子专用材料研发、制造、销售有关的经营范围，但其主要产品和实际从事的主营业务与发行人主要产品和主营业务有较大差异，未从事与发行人主营业务相同或类似的业务。

②资产独立

发行人拥有的房屋所有权、土地使用权、注册商标专用权、专利权、软件著作权等主要财产的权属凭证合法有效、取得方式合法并为发行人实际占有，上述资产未被司法冻结或设置抵押、质押等权利负担，亦不存在法律纠纷或潜在争议，发行人与上述企业不存在资产混同的情况。

③财务独立

发行人设置了独立的财务会计部门，建立了独立的会计核算体系和财务管理制度，能够独立作出财务决策，具有规范的财务会计制度和对控股子公司的财务管理制度，独立进行财务运作，依法独立进行纳税申报和履行缴纳义务。发行人拥有独立的银行账户，不存在与发行人控股股东、实际控制人控制的其他企业共用银行账户的情形。

④机构和人员独立

发行人已经建立健全了内部经营管理机构，独立行使经营管理职权，发行人相关管理层人员与发行人控股股东、实际控制人控制的其他企业不存在机构和人员混同的情形。

综上所述，发行人控股股东、实际控制人控制的其他企业与发行人在业务、资产、财务、机构和人员等方面互相独立，不存在从事与发行人主营业务相同或相似的业务，与发行人不构成同业竞争。

3、实施募投项目是否新增重大不利影响同业竞争情形

本次发行募集资金总额扣除发行费用后将用于微波电子元器件生产基地建设项目、研发中心建设项目和补充流动资金，与公司主营业务及发展目标相匹配。发行人本次募集资金全部用于现有主营业务的发展，不会因募集资金投资项目的实施新增同业竞争。

4、未来避免同业竞争的措施及其有效性

发行人控股股东、实际控制人已出具长期有效的《关于避免同业竞争的承诺函》并承诺如下：

- “1、本人确认及保证目前不存在与发行人及其子公司进行同业竞争的情况；
- 2、本人不会在中国境内外以任何方式（包括但不限于独资经营、合资经营、租赁经营、承包经营、委托经营和拥有在其他公司或企业的股票或权益等方式）从事与发行人及其子公司的业务有竞争或可能构成同业竞争的业务或活动；
- 3、如果将来有从事与发行人及其子公司构成同业竞争的业务之商业机会，本人所控制的企业将无偿将该商业机会让给发行人及其子公司；
- 4、如发行人及其子公司进一步拓展其产品及业务范围，本人所控制的企业将不与拓展的产品、业务相竞争。违反以上承诺导致发行人及其子公司遭受直接或者间接经济损失，本人将向发行人及其子公司予以充分赔偿或补偿；本人因违反上述承诺所取得全部利益归发行人所有。本人在该承诺函中所作出的保证和承诺均代表本人及本人控制的其他企业而作出。”

发行人控股股东、实际控制人作出的上述承诺已部分履行且仍在持续履行中，不存在违反相关承诺的情形，不存在损害发行人利益的情况。发行人控股股东、实际控制人作出的《关于避免同业竞争的承诺函》目前处于正常履行状态，相关承诺尚未到期，以上承诺暂不存在不能实施的实质性法律障碍；承诺函对于违约的情形做出了明确约定，避免同业竞争的措施具有有效性；不存在违反承诺的情形，不存在损害上市公司利益的情形。

综上所述，发行人控股股东、实际控制人作出的关于避免解决同业竞争的承诺处于正常履行状态，不存在不能实施的实质性法律障碍，避免同业竞争的措施具有有效性；发行人控股股东、实际控制人不存在违反承诺和损害发行人利益的情形。发行人本次发行及实施募投项目不会新增显失公平的关联交易和重大不利影响的同业竞争，不存在相关风险。

二、核查程序

保荐机构、会计师执行了如下核查程序：

1、查阅发行人关联销售和关联采购明细表，核查交易内容，并与本次募投项目涉及的相关产品进行对比分析。

保荐机构、发行人律师执行了如下核查程序：

1、查阅发行人控股股东、实际控制人填写的调查表，了解发行人控股股东、实际控制人控制的其他企业情况；

2、查阅发行人控股股东、实际控制人控制的其他企业现行有效的营业执照、《公司章程》、财务报表、正在履行的重大业务合同、固定资产清单以及关于主营业务及主要产品的说明；

3、获取并查阅发行人出具的说明文件，访谈发行人财务负责人，了解发行人与其控股股东、实际控制人控制的其他企业是否业务相同或相似，是否存在实质性同业竞争；

4、获取并查阅发行人关于同业竞争的情况说明，了解同业竞争的解决情况；

5、查阅本次发行募集资金使用可行性分析报告及发行预案，了解本次募投项目所涉主营业务情况；

6、获取并查阅发行人出具的说明文件、发行人相关公告文件以及发行人控股股东、实际控制人出具的关于避免同业竞争的承诺，核查发行人控股股东、实际控制人出具的关于避免同业竞争的承诺内容。

三、核查意见

经核查，保荐机构、会计师认为：

1、发行人关联销售和关联采购的内容与本次募投项目的陶瓷电容器、环形器及隔离器等产品无关，本次募投项目实施后，不会新增关联交易。

经核查，保荐机构、发行人律师认为：

1、控股股东、实际控制人控制的其他企业与发行人在业务、资产、财务、机构和人员等方面互相独立，不存在从事与发行人主营业务相同或相似的业务，与发行人不构成同业竞争；

2、发行人本次募集资金全部用于现有主营业务的发展，不会因募集资金投资项目的实施新增同业竞争；

3、发行人控股股东、实际控制人作出的关于避免解决同业竞争的承诺处于正常履行状态，不存在不能实施的实质性法律障碍，避免同业竞争的措施具有有效性；

4、发行人控股股东、实际控制人不存在违反承诺和损害发行人利益的情形。

问题四

报告期各期，发行人的主营业务毛利率水平为 66.20%、67.43%、69.18%、69.96%。非固体电解质钽电容器、陶瓷电容器毛利率呈现持续上升趋势，2021 年一季度毛利率分别为 82.53%、89.08%，发行人毛利率高于同行业可比公司，且发行人选取三个可比公司中国振华（集团）科技股份有限公司（以下简称振华科技）、福建火炬电子科技股份有限公司（以下简称火炬电子）、北京元六鸿远电子科技股份有限公司（以下简称鸿远电子）中，鸿远电子无钽电容相关业务。

请发行人补充说明：（1）结合各细分产品定价依据与成本控制情况、同行业可比公司情况、说明发行人产品毛利率较高的原因及合理性，该毛利率水平是否可持续；（2）发行人选取可比公司振华科技、火炬电子、鸿远电子的主要依据及合理性，未选取其他主营陶瓷电容器的上市公司的原因及合理性，选取依据和选取结果是否符合《创业板上市公司证券发行上市审核问答》问答 22 的相关规定。

请发行人补充披露（1）相关的风险。

请保荐人和会计师核查并发表明确意见。

回复：

一、对问题的回复

（一）结合各细分产品定价依据与成本控制情况、同行业可比公司情况、说明发行人产品毛利率较高的原因及合理性，该毛利率水平是否可持续

1、产品定价依据

公司主要产品为高可靠电子元器件产品，应用于车辆、飞行器、船舶、雷达、电子等系统工程和装备领域，存在较多的定制化需求，要求产品可靠性高、在复杂环境中运行稳定，产品从设计、试用到进入合格供应商目录开始量产需要经过多重严格检验，涉及工艺较为复杂，筛选和检验标准较严格，对工艺技术要求也较高，因此高可靠产品一般定价相对较高。

2、成本控制情况

发行人制订并执行了采购与付款相关内控制度，严格筛选合格供应商，并与其达成长期合作，以确保材料采购价格稳定合理。发行人技术部门负责制定材料的消耗定额，从产品的设计和工艺技术上保证产品质量优、成本低、适销对路，减少原材料等各种材料消耗，节约工时，讲究经济效益。其次，各事业部负责控制材料消耗，努力提高设备的利用水平，并对开展正常业务开支的费用进行严格控制。人力资源部负责制定劳动定额、绩效考核、工资总额计划的实施，严格控制人工成本。设备部通过对设备的日常维护保养和提高维修质量，确保设备的长期正常运转状态，并加强对维修费用和备品备件更新费用的节约和控制。

3、与同行业可比公司对比情况

报告期内，发行人与可比公司主要产品类型的毛利率对比情况具体如下：

项目	2021年1-6月			2020年度		
	宏达电子	火炬电子	鸿远电子	宏达电子	火炬电子	鸿远电子
非固体电解质钽电容器	81.10%	32.10%	/	81.22%	5.56%	/
固体电解质钽电容器	61.06%		/	56.07%		/
微电路模块	78.15%	/	/	80.10%	/	/
陶瓷电容器	85.04%	81.67%	未披露	89.46%	74.59%	80.05%
代理产品	/	13.79%	未披露	/	13.95%	10.08%
综合毛利率	69.96%	36.42%	54.26%	69.15%	31.85%	46.75%
项目	2019年度			2018年度		
	宏达电子	火炬电子	鸿远电子	宏达电子	火炬电子	鸿远电子
非固体电解质钽电容器	78.79%	39.25%	/	78.62%	43.96%	/
固体电解质钽电容器	56.04%		/	57.66%		/
微电路模块	61.18%	/	/	43.34%	/	/
陶瓷电容器	79.14%	70.19%	79.27%	78.78%	72.58%	80.16%
代理产品	/	15.65%	13.83%	/	21.77%	18.82%
综合毛利率	66.73%	32.12%	50.48%	66.05%	35.07%	51.31%

注1：振华科技披露的产品分类为“新型电子元器件、整机及系统、现代服务业”，未披露更细的产品类型，因此未列入对比范围；

注2：火炬电子披露的产品分类为“陶瓷电容器、钽电容器、陶瓷材料、单层电容器、微波薄膜元器件、温度补偿衰减器、电阻、其他、代理产品”；

注3：鸿远电子披露的产品分类为“瓷介电容器、直流滤波器、代理产品”。

报告期内，公司销售毛利率高于同行业平均水平，主要系各家可比上市公司产品类型、产品结构、应用领域彼此之间均有所不同所致。

钽电容器方面，报告期内火炬电子的毛利率低于发行人，且存在较大波动，主要由于钽电容器并非其主要业务，报告期内其收入占营业收入比例分别为1.67%、1.63%、1.41%和1.31%，占比较低；陶瓷电容器方面，报告期内发行人的毛利率与火炬电子和鸿远电子基本相近，与行业可比公司不存在重大差异。

综合毛利率方面，火炬电子和鸿远电子低于发行人，主要由于两家可比公司均存在较大比例的代理业务。报告期内，火炬电子代理业务收入占营业收入比例分别为70.19%、67.79%、67.61%和64.15%，鸿远电子代理业务收入占营业收入比例分别为46.82%、43.82%、47.53%和39.35%，而代理业务毛利率均在10%-20%左右，因此拉低综合毛利率。

综上所述，发行人综合毛利率高于同行业可比公司主要由于可比公司低毛利率的代理业务占比较高，拉低综合毛利率，但同类产品毛利率与同行业可比公司相比基本接近，不存在重大差异。

4、发行人产品毛利率较高的原因及合理性，是否可持续

结合上述分析，发行人高可靠产品面向我国车辆、飞行器、船舶、雷达、电子等系统工程和装备等领域，产品定制化程度高，对产品技术水平有严格要求，因此高可靠产品价格较高，同时发行人进行了较为严格的成本控制，使得公司产品毛利率整体处于较高水平。此外，与同行业可比公司的同类产品实现的毛利率相比，毛利率水平基本接近，符合行业整体情况，具有合理性。

发行人高可靠产品的下游主要由国有高可靠产业集团组成，各集团拥有大量的子公司与研究所等分支机构，涵盖车辆、飞行器、船舶、雷达、电子等系统工程和装备等多个领域，客户数量众多。随着我国经济的飞速成长，高可靠行业也将持续增长，对高可靠产品的需求将进一步增加。由于高可靠产品市场具有较高的技术和资质壁垒，国外相关企业较难进入国内高可靠产品市场，国内有能力提供可以满足高可靠产品客户需求的企业数量相对较少，因此国内高可靠产品生产厂商具有较强的竞争力，高可靠产品价格具备较大优势，在可预见的未来，发行人可以维持较高的毛利率水平。

(二) 发行人选取可比公司振华科技、火炬电子、鸿远电子的主要依据及合理性，未选取其他主营陶瓷电容器的上市公司的原因及合理性，选取依据和选取结果是否符合《创业板上市公司证券发行上市审核问答》问答 22 的相关规定

发行人主要从事高可靠电子元器件和电路模块的研发、生产、销售及相关服务业务，根据中国证监会颁布的《上市公司行业分类指引》，发行人属于计算机、通信和其他电子设备制造业（分类代码：C39）。截至2021年6月30日，C39计算机、通信和其他电子设备制造业上市公司共有456家，剔除ST类公司后共有440家。由于计算机、通信和其他电子设备制造业范围较广，公司主营的高可靠电子元器件和电路模块仅为其中的一个子行业。

发行人主要产品类型包括钽电容器、微电路模块、陶瓷电容器和其他产品，其中，钽电容器产品（包括非固体电解质钽电容器、固体电解质钽电容器）合计含发行人主营业务收入的比例在报告期各期均超过60%，在最近一年及一期占比分别为61.20%和60.64%，为发行人核心产品；微电路模块产品在最近一年及一期占比分别为8.15%和10.05%；陶瓷电容器产品在最近一年及一期占比分别为8.68%和8.39%。国内同样主要经营前述产品的上市公司较少，除发行人外仅有三家公司较为可比，具体情况如下：

1、振华科技（000733.SZ）：其下属全资子公司中国振华（集团）新云电子元器件有限责任公司主营高可靠性的钽、铝电解电容器。

2、火炬电子（603678.SH）：主营陶瓷电容器、钽电容器、陶瓷材料及相关产品。2020年度火炬电子陶瓷电容器、钽电容器产品占其营业收入的比例分别为23.95%和1.41%。

3、鸿远电子（603267.SH）：主营多层瓷介电容器等电子元器件。2020年度鸿远电子多层瓷介电容器产品占其营业收入的比例为51.48%。

风华高科（000636.SZ）从事的业务仅中有少量陶瓷电容器产品，但总体占比较小，因此可比度较低。此外，其他主营电容器的上市公司，产品多聚焦在铝电容器（如江海股份（002484.SZ）、海星股份（603115.SH）、艾华集团（603989.SH）），或者薄膜电容器（航天彩虹（002389.SZ）、铜峰电子（600237.SH）、

法拉电子（600563.SH）等电容器产品，与发行人钽电容器和陶瓷电容器产品相似度较低，因此可比度较低。

综上，发行人同行业可比公司选取完整、合理，符合《创业板上市公司证券发行上市审核问答》问答22的相关规定。

二、补充披露内容

针对发行人未来是否可以维持较高毛利率，发行人已在募集说明书之“重大事项提示”和“第六节 与本次发行相关的风险因素”之“四、税收及财务风险”补充披露内容如下：

“（四）毛利率波动的风险

报告期内，公司主营业务毛利率和综合毛利率整体相对较高且呈增长态势，主要受行业景气度较高、下游客户需求不断增加、行业技术和资质壁垒较高、高可靠产品定价具备较大优势、公司竞争力较强以及成本控制严格等多方面因素影响。如果未来出现行业政策变化、下游需求缩紧、市场竞争加剧、原材料价格大幅上涨、人工成本大幅上升等不利因素，发行人主营业务毛利率和综合毛利率水平可能会出现下滑的风险。”

三、核查程序

保荐机构、会计师执行了如下核查程序：

1、了解发行人销售与收款循环、采购与付款循环及生产仓储循环相关的内控制度，执行相应控制测试，以确认内部控制的有效性；

2、通过对报告期内重大销售、采购订单及相关原始凭证的抽样，了解、掌握发行人主要客户、供应商情况，并对报告期内记录的客户及供应商选取样本，对其交易金额和往来款进行了函证和走访，核查其收入和采购成本的真实性和准确性；

3、对销售收入执行截止性测试，确认发行人的收入成本确认是否记录在正确的会计期间；

4、从公开市场中获取同行业上市公司基本信息和财务报告，对国内同样经营相似业务的同行业上市公司进行梳理，根据并对发行人报告期各产品毛利率与

同行业可比公司进行对比分析；

5、查阅《创业板上市公司证券发行上市审核问答》第 22 条的规定，核查公司是否符合相关规定。

四、核查意见

经核查，保荐机构、会计师认为：

1、发行人高可靠产品定制化程度高，对产品技术水平有严格要求，因此高可靠产品价格较高，同时发行人进行了较为严格的成本控制，使得公司产品毛利率整体处于较高水平，但同类产品毛利率与同行业可比公司相比基本接近，符合行业整体情况，具有合理性；该毛利率水平在可预见的未来可以持续；

2、发行人同行业可比公司选取完整、合理，符合《创业板上市公司证券发行上市审核问答》（以下简称《审核问答》）第 22 条的相关要求；

3、发行人已在募集说明书中补充披露上述问题所涉及的相关风险。

问题五

发行人拟使用募集资金 6.2 亿元投向微波电子元器件生产基地建设项目（以下简称“电子元器件项目”），该项目涉及的产品包括陶瓷电容器和环形器及隔离器，均为发行人现有产品，不涉及拓展新业务和新产品，项目达产将新增陶瓷电容器产能 20 亿只/年，新增环形器及隔离器产能 150 万只/年。项目建设地位于湖南省株洲市高新技术产业开发区天易科技城 K2 地块，尚未取得相关产权证书。项目达产预计实现营业收入 50,570.43 万元，税后内部收益率(IRR)18.71%。发行人现有陶瓷电容器产能 4,176 万只/年。前次募投项目新型低 ESR 有机高分子聚合物电容器生产线建设项目承诺效益的实现期晚于预测，主要是由于高可靠单位对新产品导入较为谨慎，验证周期较长，尚处于需求爬坡期。

请发行人补充说明：（1）请结合行业竞争格局、发行人竞争优势、现有或潜在客户情况，所处行业发展前景、下游客户需求与协议签订情况、产能消化措施，同行业可比公司项目投资情况等说明本次投资规模的必要性和产能规模的合理性，民用产品是否存在市场开拓不及预期的风险，是否存在产能过剩风险；（2）结合相关产品毛利率情况、单位价格、成本、毛利率等关键参数，说明预计效益测算依据、测算过程及合理性，高可靠产品效益测算是否充分考虑高可靠单位验证周期的影响；（3）结合前次及本次募投项目的建设进度、预计达产时间及产生收入情况，说明预计未来相关新增资产折旧和摊销情况；（4）说明募投项目用地的计划、取得土地的具体安排、进度，如无法取得募投项目用地拟采取的替代措施以及对募投项目实施的影响等。

请发行人补充披露（1）（2）（3）（4）中的风险。

请保荐人和会计师核查并发表明确意见。

回复：

一、对问题的回复

(一) 请结合行业竞争格局、发行人竞争优势、现有或潜在客户情况，所处行业发展前景、下游客户需求与协议签订情况、产能消化措施，同行业可比公司项目投资情况等说明本次投资规模的必要性和产能规模的合理性，民用产品是否存在市场开拓不及预期的风险，是否存在产能过剩风险

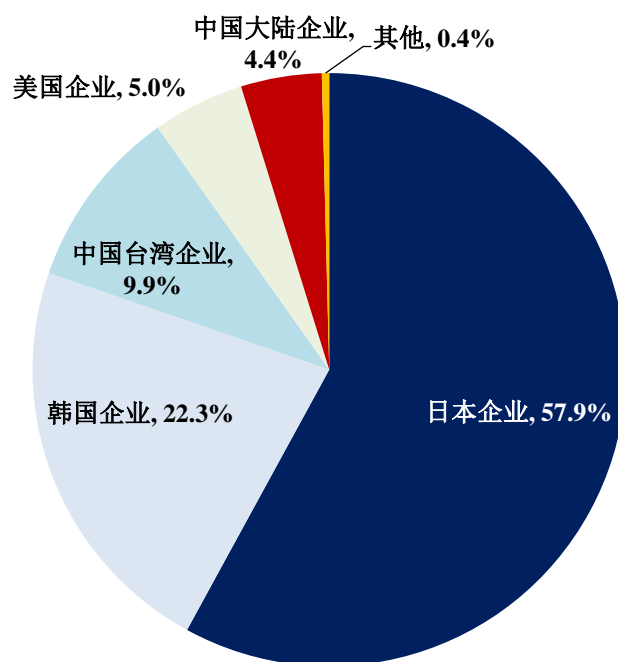
本次募投项目涉及的产品包括陶瓷电容器和环形器及隔离器，具体情况如下：

1、行业竞争格局

(1) 陶瓷电容器

①陶瓷电容器国产化率较低

陶瓷电容器全球市场竞争格局较为集中，且由日、韩厂商主导，国内陶瓷电容器制造企业在全球的市场占有率处于较低水平。2019年，全球前十大陶瓷电容器厂商中，日本厂商全球市场占有率约57.9%，韩国厂商全球市场占有率约22.3%，而我国大陆企业仅占4.4%，具体如下：



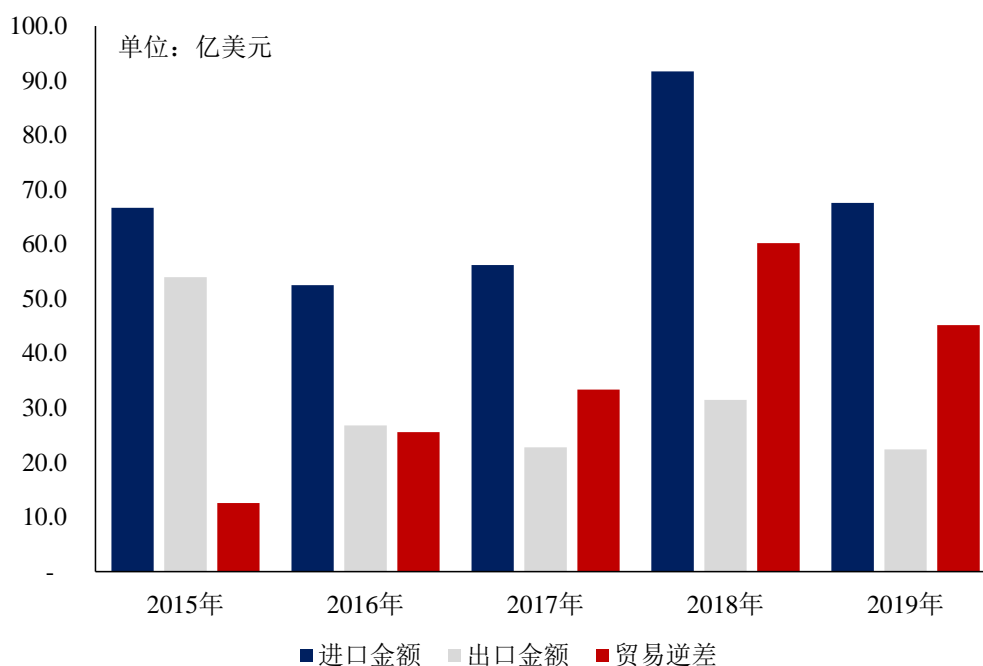
数据来源：《2020 年版中国 MLCC 市场竞争研究报告》

②我国是陶瓷电容器的主要消费市场，但贸易逆差仍处于较高水平

我国是全球最大的消费电子生产国、出口国和消费国，2018年我国生产的智能手机、电脑和彩电产量分别占全球的90%、90%和70%以上。广阔的下游消费

电子市场对陶瓷电容器需求大幅提升，根据中国电子元件行业协会数据，2017年我国陶瓷电容器需求量占全球需求总量的68.4%，成为全球最大的陶瓷电容器消费市场，而到2018年中国陶瓷电容器消费量达到28,890亿只，占全球消费比重提升至71.3%，预计2023年中国大陆消费量将提升至34,810亿只，2019-2023年复合增速为4.77%。

我国是陶瓷电容器最大的消费市场，但由于日本、韩国等国家在陶瓷电容器领域有着多年的先发优势，我国陶瓷电容器贸易逆差仍处于较高水平，具体如下：



数据来源：《2020年版中国MLCC市场竞争研究报告》

③陶瓷电容器的主要厂商情况

陶瓷电容器主要生产厂商情况如下：

公司名称	所属国家或地区	业务简介
村田	日本	村田制作所是全球领先的电子元器件制造商，主要产品包括陶瓷电容器、陶瓷滤波器、高频零件、感应器等，陶瓷电容器市场占有率全球第一
三星电机	韩国	三星电机有限公司是三星集团子公司，主要从事消费性电子、半导体制造、面板、家电等业务，是全球第二大陶瓷电容器生产厂商
TDK	日本	TDK株式会社，主要产品包括陶瓷电容器、铝电解电容器、薄膜电容器、磁性产品、高频元件、压电和保护器件、环形器及隔离器等各类被动元器件

公司名称	所属国家或地区	业务简介
太阳诱电	日本	太阳诱电株式会社主要产品包括储能元器件、光通信元器件、无线通信模块等，是全球领先的陶瓷电容器生产厂商之一
国巨	中国台湾	国巨股份有限公司是中国台湾第一大无源元器件生产厂商，主要产品包括皮膜金属、氧化皮膜、绕线电阻、薄膜贴片电阻、网络电阻，陶瓷电容器等
华新科	中国台湾	华新科技股份有限公司是中国台湾第二大无源元器件生产厂商，主要产品包括陶瓷电容器、晶片电阻及晶片排阻、射频元件、圆板电容、氧化锌变阻器、电感等
鸿远电子	中国大陆	鸿远电子（603267.SH）是以多层瓷介电容器等电子元器件的技术研发、产品生产和销售为主营业务的民营企业，自产产品主要包括多层瓷介电容器以及直流滤波器
火炬电子	中国大陆	火炬电子（603678.SH）主要从事电容器及相关产品的研发、生产、销售、检测及服务业务，自产产品包括陶瓷电容器、钽电容器、陶瓷材料、微波薄膜元器件等
风华高科	中国大陆	风华高科（000636.SZ）主要从事高端新型电子材料、元器件、电子专用设备等信息基础产品的生产和销售，主要产品为陶瓷材料、片式电阻、片式电容、FPC 线路板等

资料来源：公司官网

陶瓷电容器生产厂商较多，但主要市场份额仍集中在日本和韩国厂商。2018年以来，国际贸易形势日趋紧张，作为应用于整个电子行业的基础元器件，陶瓷电容器产品供给的安全性是我国电子行业的持续发展的重要保障，因此，国内陶瓷电容器生产厂商的技术水平和生产能力的提升具有重要意义。

（2）环形器及隔离器

环形器及隔离器主要应用于移动通信领域，是重要的射频无源器件，主要用于实现电磁波信号单向环形传输。环形器及隔离器主要生产厂商情况如下：

公司名称	所属国家或地区	业务简介
TDK	日本	TDK 株式会社，主要产品包括陶瓷电容器、铝电解电容器、薄膜电容器、磁性产品、高频元件、压电和保护器件、环形器及隔离器等各类被动元器件
日立金属	日本	日立金属株式会社，主要产品包括金属材料、磁性材料两大品类，同时亦生产和销售电容器、环形器及隔离器等元器件，产品应用于新能源汽车、电子设备、工业基础设施等
Partron	韩国	Partron Co., Ltd.是从三星电子分离出一家公司，主要从事射频器件的开发与制造，主要产品包括滤波器、双工器、环形器及隔离器、贴片天线等
Skyworks	美国	Skyworks Solutions, Inc. 是高性能模拟半导体的生产厂家，主要产品包括放大器、衰减器、环形器及隔离器、解调器、检测器、二极管、定向耦合器等

公司名称	所属国家或地区	业务简介
天和防务	中国	天和防务（300397.SZ）旗下子公司华扬通信的主要产品为环形器及隔离器同频合路器、远端大功率负载、铁氧体、硅钼棒、双工器、滤波器、塔顶放大器等
国睿科技	中国	国睿科技（600562.SH）是中国电子科技集团公司第十四研究所旗下上市公司，主要产品包括雷达整机系统和子系统、大功率脉冲电源、微波组件、环形器及隔离器、轨道交通控制系统以及二次雷达集成产品等

资料来源：公司官网

环形器及隔离器是通信领域的重要元器件，上述通信及电子元器件领域主流公司的产品对环形器及隔离器有所覆盖，但均非主要产品。发行人本次募投项目新增150万只环形器及隔离器产能，主要系满足高可靠领域和通信领域客户的需求，提高产品的多样性，进一步提升发行人的综合客户服务能力。

2、发行人竞争优势

（1）深耕高可靠领域多年形成的技术积淀和工艺水平

电子元器件是我国制造业高端化、信息化、智能化发展的关键，其性能直接影响各类工业装备、终端产品的性能与可靠性，尤其是高可靠领域，对电子元器件的性能、质量等要求更高。发行人深耕高可靠电子领域20余年，获得下游高可靠领域客户的高度认可，在提升产品性能、增强产品可靠性和一致性等方面积累了丰富的研发和生产工艺经验。

（2）与大型集团客户保持良好的合作关系

发行人以高质量产品切入航空航天、信息化领域等高可靠、高附加值市场，并率先形成批量化供应。发行人主要客户包括中国航空工业集团、中国电子科技集团、中国兵器装备集团、中国航天科技集团、中船重工集团等大型高可靠领域优质集团客户，凭借先进的工艺技术和可靠的产品品质，发行人获得了下游客户的高度认可，曾获得多个大型客户授予的“优秀供应商”奖项。该类客户对于供应商的认证要求较高、认证时间较长，一旦与供应商建立合作将保持长期稳定的合作关系，发行人具有明显的客户资源优势。

（3）资质与认证优势

高可靠领域，以及通信、消费电子、汽车电子和工业装备等行业对上游供应商的资质和生产线认证条件较高，未经其认证的生产线无法为其提供相关产品。发行人目前陶瓷电容器和环形器及隔离器生产线均已通过高可靠贯标认证，部分产品进入电子元器件QPL目录。此外，发行人实验中心通过了CNAS和DILAC能力认可，部分产品已通过AS9100D航空航天质量管理体系及IATF 16949汽车质量管理体系认证。

（4）拥有成熟的营销渠道和销售体系

根据产品的特征、用户的需求等因素，发行人建立了较为完善的全国销售网络系统。针对不同地区客户，发行人设置了相应的销售专员，对客户一对一服务，经过多年发展，发行人完成高可靠市场渠道的建立，并利用成熟的营销团队优势，开拓新产品的市场。

此外，发行人一方面配备了专业的销售团队，并定期对销售人员进行专业知识培训，不断提高发行人销售团队实力；一方面也建立了行之有效的销售方针，通过对市场开展积极调研，洞察市场上对新产品、新技术的需求，以确定销售方向，上报并经发行人销售经理评估通过之后提早布局新业务机会。

3、发行人现有或潜在客户情况

报告期内，发行人陶瓷电容器和环形器及隔离器的收入情况如下：

单位：万元

项目	2021年1-6月	2020年度	2019年度	2018年度
陶瓷电容器	7,740.21	12,160.62	7,497.56	4,080.99
环形器及隔离器	546.20	1,951.77	366.57	201.09
合计	8,286.41	14,112.39	7,864.13	4,282.08

如上表所示，报告期内，发行人陶瓷电容器的收入分别为4,080.99万元、7,497.56万元、12,160.62万元和7,740.21万元，环形器及隔离器的收入分别为201.09万元、366.57万元、1,951.77万元和546.20万元，整体呈逐年快速增长趋势。

发行人陶瓷电容器产品已向中国航天工业集团有限公司、中国航天科工集团有限公司、中国电子科技集团有限公司、中国兵器装备集团有限公司、四川新易

盛通信技术有限公司、武汉昱升光电股份有限公司、武汉光迅科技股份有限公司，以及通讯及其他设备相关上市公司等批量供货，并向海尔集团公司、珠海格力集团有限公司、海信集团有限公司等大型电器集团，和国内大型通信设备集团等客户小批量送样。

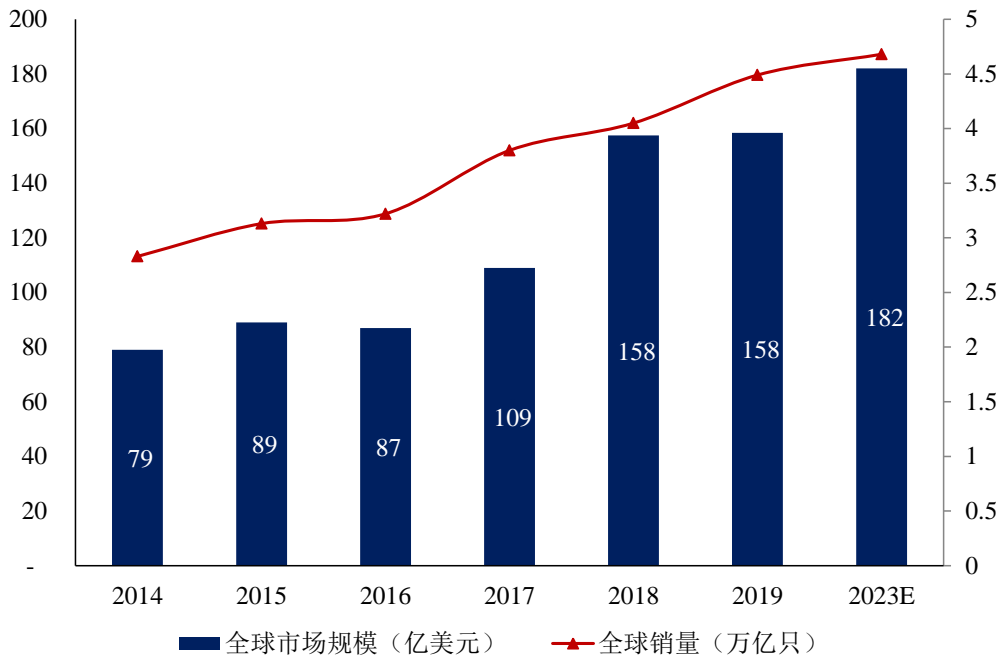
发行人环形器及隔离器产品目前主要向中国电子科技集团公司、中国航天科技集团公司、成都雷电微力科技股份有限公司等客户批量供货，并向国内大型通信设备集团小批量送样。

4、所处行业发展前景

（1）陶瓷电容器发展前景

①行业总体规模较大且呈持续增长趋势

陶瓷电容器应用领域广泛，包括航天、航空、船舶、武器装备、通信设备、消费电子、汽车电子等，是世界上用量最大、发展最快的电子元件之一。根据中国电子元件行业协会数据，2019年，全球陶瓷电容器市场规模约158亿美元，销量约4.5万亿只，且未来将持续增加，预计2023年全球市场规模将达到182亿美元，具体如下：



数据来源：中国电子元件行业协会

②我国制造业高端化、信息化、智能化建设提速

近年来，随着信息化、智能化在制造领域的快速发展和应用，相应带动上游电子元器件的需求大幅上升。根据“十四五”期间“深入实施制造强国战略”、“推进产业基础高级化、产业链现代化，保持制造业比重基本稳定，增强制造业竞争优势，推动制造业高质量发展”、“深入实施智能制造和绿色制造工程，发展服务型制造新模式，推动制造业高端化智能化绿色化”等建设目标要求，我国制造业高端化、信息化、智能化进程正加速推进，预计未来对电子元器件的需求将进一步提高。

陶瓷电容器是广泛应用于航天、航空、船舶、武器装备、通信设备、消费电子、汽车电子等众多领域的基本元件，其占整个电容器市场规模的比例超过50%，在我国制造业高端化、信息化、智能化建设全面提速的背景下，未来市场空间较大。

③核心电子产业自主可控和国产替代加速

2018年以来，国际贸易形势日趋紧张，我国政府和大量终端设备厂商意识到尽快实现上游核心供应链自主可控的重要性，我国政府相应提出一系列加速推进核心电子产业国产替代和自主可控的支持政策，“十四五规划”中明确提出“坚持自主可控、安全高效，推进产业基础高级化、产业链现代化”、“聚力国防科技自主创新、原始创新”，以及“培育壮大核心电子元器件等产业水平”等。

根据工信部发布的《基础电子元器件产业发展行动计划（2021-2023年）》，到2023年，我国电子元器件销售总额需达到2.1万亿元，进一步巩固我国作为全球电子元器件生产大国的地位，并形成一批具有国际竞争优势的电子元器件企业，力争15家企业营收规模突破100亿元。

随着国际贸易环境变化和国内政策的推动下，我国核心电子产业的自主可控和国产替代进程将进一步加速，从而大幅增加陶瓷电容器等电子元器件的需求。

（2）环形器及隔离器发展前景

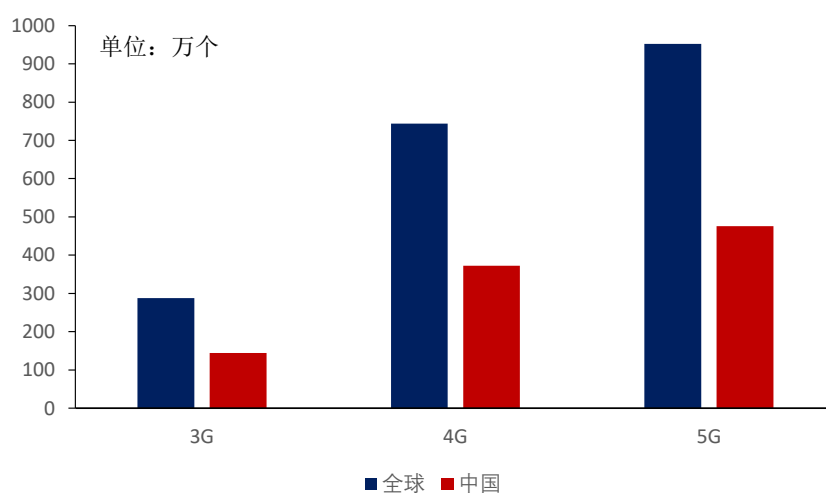
环形器及隔离器主要应用于移动通信领域，是重要的射频无源器件，新一代通信技术的快速发展推动环形器及隔离器的市场需求大幅增加。

①5G核心技术使得单个基站的环形器及隔离器用量增加

一般而言，通信基站中一个天线通道需使用一组环形器及隔离器，5G时代，大规模天线（Massive MIMO）技术的普遍应用，使得单个天线通道数由4G时代的2-8通道，增长到64通道，从而大幅增加环形器及隔离器的用量。根据国盛证券研究所测算，5G时代，全球环形器及隔离器的市场容量将达到4G时代的15倍以上，对环形器及隔离器的需求达16亿只。

②5G基站建设数量大幅增加使得环形器及隔离器需求量增加

通信技术的更迭带来信息传输速率和频率的提升，同等环境下的信号传输距离则相应降低，从2G到5G，单个基站的信号覆盖半径不断缩小，使得基站部署密度不断提升，而基站数量的增加直接推动环形器及隔离器等射频器件需求量的上升。工信部对未来3G、4G通信基站数量以及5G基站部署预测情况如下：



数据来源：工信部，Technology Business Research

市场研究机构通常认为，5G基站建设规模将是4G基站的1.2-1.5倍，而中国5G基站建设规模占全球基站数量的一半。环形器及隔离器作为基站的重要配件，其市场需求量将随着5G基站建设规模的大幅提升而增加。

5、产能消化措施

(1) 广阔的市场空间和持续增长的市场需求是本次募投项目相关产品产能消化的基础

陶瓷电容器应用领域广泛，是航天、航空、船舶、武器装备、通信设备、消费电子、汽车电子等众多领域的基本元件，根据中国电子元件行业协会数据，2019年，全球陶瓷电容器市场规模约158亿美元，销量约4.5万亿只，且未来将持续增加，发行人本次新增20亿只陶瓷电容器产能，按照上述行业协会数据测算仅占全球陶瓷电容器的市场份额的0.04%。

环形器及隔离器是通信基站的射频无源器件，5G时代基站数量以及单个基站天线通道数的大幅提升，使得环形器及隔离器的需求相应提升。根据国盛证券研究所测算，5G时代，全球环形器及隔离器的需求达16亿只，发行人本次新增150万只环形器及隔离器产能，按照上述行业协会数据测算仅占全球环形器及隔离器市场份额的0.09%。

此外，在当前国际形势和我国核心电子产业国产替代加速的背景下，国内核心电子元器件厂商迎来了良好的历史发展机遇。发行人本次募投项目新增陶瓷电容器和环形器及隔离器产能，在提升大型客户服务能力和市场竞争力的同时，亦将助力我国核心电子产业自主可控进程的稳步推进。

（2）良好的客户合作关系是本次募投项目相关产品产能消化的重要保障

发行人与大型高可靠集团、通信、消费电子、汽车电子和工业装备等领域的终端厂商合作多年，依靠突出的研发能力和可靠的产品质量，得到了客户的高度认可，曾获得多个大型客户授予的“优秀供应商”奖项，形成了重要战略合作伙伴关系。出于对质量可靠性和服务稳定性的考虑，上游供应商一旦进入上述大型厂商的供应链，则倾向于建立长期、稳定的合作关系，发行人良好的客户合作关系则能有效保障本次募投项目相关产品的产能消化。

（3）持续完善营销体系建设，加大民用市场开发力度

发行人将在高可靠领域的基础上，持续开拓消费电子、通信、汽车电子等市场，提升在国内电子元器件生产企业中的市场地位，主要计划和措施包括：

①加强市场部门职能建设，做好市场调研工作，及时收集市场信息，指导新产品开发决策。

②继续推进以大客户为核心的销售策略，综合分析过往经验，进行全方位的服务提升，以满足客户的各种需求。持续做好产品信息反馈、品质保证等方面的

工作，争取更多高端产品采购订单。

③针对陶瓷电容器和环形器及隔离器设立专门的研发、生产、销售团队，加快相关产品的研发与量产的速度，增强公司核心竞争力。

(4) 加强人才引进及员工培训，提升研发、生产与管理水平

为提高企业的市场竞争力，实现快速、健康、持续发展，发行人将人才视为企业的根本，通过各种有效的方式培养、引进人才，逐步调整人才结构，构建具有较强实力的科技创新人才队伍。发行人将持续完善人力资源管理制度，加强员工培训，并且将重点引进多名陶瓷电容器和环形器及隔离器等方面的人才，增强研发团队实力，提升研发、品质及生产管理水平。

6、下游客户需求及协议签订情况

首先，在高可靠领域，发行人已与众多高可靠领域集团签订正式协议，并批量供应陶瓷电容器和环形器及隔离器产品。报告期内，发行人已实现陶瓷电容器收入分别为4,080.99万元、7,497.56万元、12,160.62万元和7,740.21万元，已实现环形器及隔离器收入分别为201.09万元、366.57万元、1,951.77万元和546.20万元，均主要为高可靠产品。

其次，在民用领域，陶瓷电容器方面，发行人现有或潜在客户的需求量较大，目前发行人受限于产能不足，仅能向四川新易盛通信技术有限公司（新易盛（300502.SZ）下属子公司）、武汉昱升光电股份有限公司、武汉光迅科技股份有限公司（002281.SZ）等客户小批量供应定制化产品，尚无法满足大型集团客户的大批量需求，如海尔集团公司、珠海格力集团有限公司、海信集团有限公司等客户对陶瓷电容器的年需求均达到20亿只以上；环形器及隔离器方面，发行人已向国内大型通信集团小批量送样，上述客户对环形器及隔离器每年的需求均达到1,000万只以上。随着相关发行人本次募投项目新增产能的逐渐释放，相关协议将进一步落实。

7、同行业可比公司项目投资情况

同行业可比公司相关项目投资情况如下：

公司名称	相关项目投资情况
陶瓷电容器：	

公司名称	相关项目投资情况
鸿远电子	“电子元器件生产基地项目”，新增高可靠多层瓷介电容器 7,500 万只，通用多层瓷介电容器 19.25 亿只，截至 2020 年末，建设进度为 42.41%，部分生产线已投产，预计可实现多层瓷介电容器产能 7 亿只/年
火炬电子	“小体积薄介质层陶瓷电容器高技术产业化项目”，新增 84 亿只陶瓷电容器，截至 2020 年末，建设进度为 32.21%，部分设备已经完成安装调试，并按计划开始带料试生产工作
环形器及隔离器：	
天和防务	“5G 环形器扩产项目”，新增 5G 环形器 10,000 万只，截至 2020 年末，项目尚处于建设阶段

资料来源：公司公告

如上表所示，上述同行业可比公司均在陶瓷电容器和环形器及隔离器领域扩张产能，以应对持续增长的市场需求。发行人本次募投项目新增20亿只陶瓷电容器和150万只环形器及隔离器产能是提高客户服务能力、巩固市场地位、提升市场竞争力的重要举措。

8、本次投资规模的必要性和产能规模的合理性，民用产品是否存在市场开拓不及预期的风险，是否存在产能过剩风险

(1) 本次募投项目投资规模具有必要性和合理性

根据前文分析，在陶瓷电容器和环形器及隔离器当前行业发行趋势及市场竞争格局下，本次募投项目新增陶瓷电容器和环形器及隔离器产能是发行人抓住行业历史发展机遇、巩固市场地位、提升市场竞争力的必要举措。相关产品产能扩张幅度和投资规模符合下游客户需求，与同行业可比公司不存在重大差异，具有合理性。

(2) 民用产品需求量较大

高可靠产品具有规格型号多、产品质量和性能要求高、定制化程度高的特点，从而形成了单价较高、销量相对较低的特点。民用产品的标准化程度高，生产工艺难度较小，单价相对较低，但需求量远高于高可靠产品。发行人目前陶瓷电容器产能较低，仅能满足现有高可靠领域客户和少量小型民用领域客户的需求，无法满足民用领域大型集团的产能要求。本次募投项目的实施，是发行人提高大型民用领域客户服务能力的重要举措。

(3) 发行人本次募投项目相关生产设备投入均可用于高可靠产品和民用产品

发行人本次募投项目引入的相关生产设备均可用于高可靠产品和民用产品。其中，高可靠产品由于产品型号众多、定制化水平高、质量和性能要求较高，生产效率相对较低，民用产品标准化程度高，生产效率相对较高。发行人深耕高可靠领域多年，本次募投项目达产后亦将优先满足现有高可靠领域客户的需求，若未来民用产品拓展不及预期，发行人将合理分配产能，利用高可靠领域的客户资源，实现募投项目的投资收益。

(二) 结合相关产品毛利率情况、单位价格、成本、毛利率等关键参数，说明预计效益测算依据、测算过程及合理性，高可靠产品效益测算是否充分考虑高可靠单位验证周期的影响

1、预计效益测算依据、测算过程及合理性

(1) 预计效益测算依据

发行人相关产品的单价、单位成本和毛利率情况如下：

①陶瓷电容器

单位：元/只

项目	募投项目预测 (运营期平均)	2021年1-6月	2020年度	2019年度	2018年度
高可靠产品：					
单价	3.13	4.63	4.50	4.14	4.24
单位成本	1.56	0.68	0.70	0.86	0.90
毛利率	50.00%	85.31%	84.51%	79.16%	78.81%
民用产品：					
单价	0.05	2.69	3.89	2.00	0.34
单位成本	0.04	0.55	1.05	0.45	0.08
毛利率	20.00%	79.45%	72.99%	77.36%	75.42%

如上表所示，报告期内，发行人高可靠陶瓷电容器单价和毛利率均较高，本次募投项目发行人充分考虑未来行业发展趋势、市场竞争格局、高可靠单位验证周期等因素，谨慎预测高可靠陶瓷电容器的单价和毛利率，低于报告期内的单价

和毛利率水平。

报告期内，发行人民用陶瓷电容器单价和毛利率亦处于较高水平，主要系发行人民用产品销售收入和销量均较低，仅为部分客户提供定制化产品所致，本次募投项目将新增20.00亿只陶瓷电容器产能，用于满足大型集团客户的标准化产品，随着规模提升，单价和毛利率将低于报告期内销售产品的单价和毛利率，发行人已充分考虑相关因素，进行谨慎预测。

②环形器及隔离器

单位：元/只

项目	募投项目预测 (运营期平均)	2021年1-6月	2020年度	2019年度	2018年度
高可靠产品：					
单价	108.56	271.57	263.93	298.63	236.38
单位成本	65.14	83.95	157.06	264.64	393.04
毛利率	40.00%	69.09%	40.49%	11.38%	-66.28%
民用产品：					
单价	18.09	44.52	578.00	507.30	-
单位成本	14.47	15.57	372.95	465.23	-
毛利率	20.00%	65.02%	35.48%	8.29%	-

如上表所示，2018年度和2019年度，发行人环形器及隔离器收入分别为201.09万元和366.57万元，尚未实现规模生产，收入和毛利率均较低；2020年度和2021年1-6月，发行人环形器及隔离器分别为1,951.77万元和546.20万元，收入大幅上升，规模效应提升，毛利率相应大幅提升。报告期内，发行人环形器及隔离器产品以高可靠产品为主，民用产品销量水平较低，仅少量定制化产品销售，因此单价高于高可靠产品。

发行人本次募投项目高可靠和民用环形器及隔离器产品的单价和毛利率预测均低于目前销售的相关产品，发行已充分考虑相关因素进行谨慎预测。

综上所述，发行人本次募投项目相关产品的单价、单位成本、毛利率预测已充分考虑报告期内生产和销售情况，并谨慎考虑未来行业发展趋势以及降价风险等因素。

(2) 预计效益测算过程及合理性

①计算期及生产负荷

本项目效益测算计算期为 10 年，其中，项目建设期 3 年，运营期 7 年。本项目建设期第 2 年开始产生收益，建设期第 2 年达产率为 40%，建设期第 3 年达产率为 80%，运营期开始达产率均按 100% 计算。

②收入测算

本项目达产后，新增陶瓷电容器产能 200,000.00 万只/年，新增环形器及隔离器产能 150.00 万只/年，达产后，收入测算如下：

产品名称	应用类别	产能（万只/年）	运营期 平均单价（元/只）	运营期 平均收入（万元）
陶瓷电容器	高可靠	11,000.00	3.13	34,377.04
	民品	189,000.00	0.05	8,956.12
	小计	200,000.00	0.22	43,333.16
环形器及隔离器	高可靠	50.00	108.56	5,427.95
	民品	100.00	18.09	1,809.32
	小计	150.00	48.25	7,237.27
合计				50,570.43

③成本及费用测算

本项目的成本及费用包括生产成本，如直接材料、直接人工、折旧与摊销、其他制造费用等，以及期间费用。

直接材料：发行人基于历史期间的原材料采购单价，相关产品的原材料用量等，测算本项目的直接材料成本。

直接人工：发行人根据本项目所需的生产人员投入及薪酬水平，测算本项目的直接人工。

折旧与摊销：按照发行人现有的折旧与摊销政策，结合本项目的固定资产和无形资产投入，计算折旧与摊销金额。

其他制造费用：根据发行人历史期间可能发生的费用进行预测，包括固定资

产维修费用、水电能源费用等。

期间费用：根据发行人历史期间费用和本项目的具体情况进行预测。

综上所述，发行本次募投项目的预计效益测算具有合理性。

2、高可靠产品效益测算是否充分考虑高可靠单位验证周期的影响

(1) 项目建设周期和达产周期已充分考虑高可靠单位验证周期

本次募投项目效益测算计算期为10年，其中，项目建设期3年，运营期7年。本项目建设期第2年开始产生收益，建设期第2年达产率为40%，建设期第3年达产率为80%，运营期开始达产率均按100%计算。

上述项目建设周期和达产周期已充分考虑高可靠单位的验证周期。

(2) 高可靠产品单价预测已充分考虑高可靠单位验证周期

如前文所述，本次募投项目高可靠产品的预测单价和毛利率水平均低于报告期内相关产品的销售情况，发行人已充分考虑高可靠单位验证周期对产品价格变化趋势的影响，预测较为谨慎。

综上所述，发行人本次募投项目高可靠产品效益测算已充分考虑高可靠单位验证周期的影响。

(三) 结合前次及本次募投项目的建设进度、预计达产时间及产生收入情况，说明预计未来相关新增资产折旧和摊销情况

1、前次募投项目建设对未来相关新增资产折旧和摊销的影响

根据众华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《前次募集资金使用情况鉴证报告》，发行人前次募集资金已全部使用完毕，相关账户已注销，前次募投项目已全部建设完毕，达到预定可使用状态，预计未来不会新增相关资产投入，亦不会新增资产折旧和摊销。

2、本次募投项目建设对未来相关新增资产折旧和摊销的影响

(1) 本次募投项目的建设进度

①微波电子元器件生产基地建设项目

本项目计划建设期为36个月，目前公司已完成项目可行性论证、厂区设计

与规划等工作。本项目具体实施进度安排如下：

进度阶段（季度）	第一年				第二年				第三年			
	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4
项目可行性论证	■											
厂区设计与规划	■	■										
土地施工及厂房建设			■	■	■	■	■	■				
设备采购及生产线建设			■	■	■	■	■	■	■	■		
设备安装调试				■	■	■	■	■	■	■	■	
试生产					■	■	■	■	■	■		
批量生产											■	■

②研发中心建设项目

本项目计划建设期为 30 个月，目前公司已完成项目可行性论证和项目选址等工作。本项目具体实施进度安排如下：

进度阶段（季度）	第一年				第二年				第三年	
	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2
项目可行性论证	■									
研发场地建设及装修		■	■	■	■	■	■			
设备采购及研发线建设				■	■	■	■	■	■	
设备安装调试					■	■	■	■	■	■
人员招聘及培训						■	■	■	■	■
系统测试及试运营								■	■	■

(2) 本次募投项目预计达产时间及产生收入情况

①微波电子元器件生产基地建设项目

本项目建设期第2年开始产生收益，建设期第2年达产率为40%，建设期第3年达产率为80%，运营期开始达产率均按100%计算。项目达产后，新增陶瓷电容器产能200,000.00万只/年，新增环行器及隔离器产能150.00万只/年，达产后，收入测算如下：

产品名称	应用类别	产能（万只/年）	运营期 平均单价（元/只）	运营期 平均收入（万元）
------	------	----------	------------------	-----------------

产品名称	应用类别	产能（万只/年）	运营期 平均单价（元/只）	运营期 平均收入（万元）
陶瓷电容器	高可靠	11,000.00	3.13	34,377.04
	民品	189,000.00	0.05	8,956.12
	小计	200,000.00	0.22	43,333.16
环形器及隔离器	高可靠	50.00	108.56	5,427.95
	民品	100.00	18.09	1,809.32
	小计	150.00	48.25	7,237.27
合计				50,570.43

②研发中心建设项目

本项目的建设目的是为公司开拓新产品、新技术和新工艺，从而实现持续的技术创新，保持市场竞争力，本项目作为非生产型项目，不直接产生效益。

（3）本次募投项目建设新增资产折旧和摊销情况

①微波电子元器件生产基地建设项目

发行人按照当前执行的折旧与摊销政策，房屋及建筑物的折旧年限为20年，机器设备折旧年限为5年。本项目预计未来新增资产的折旧和摊销情况如下：

单位：万元

项目	折旧年限	折旧和摊销金额		
		第1年	第2年	第3年及以后
房屋及建筑物	20年	792.00	792.00	792.00
机器设备	5年	2,749.56	6,234.42	7,123.89
合计		3,541.56	7,026.42	7,915.89

②研发中心建设项目

发行人按照当前执行的折旧与摊销政策，房屋及建筑物的折旧年限为20年，机器设备折旧年限为5年。本项目预计未来新增资产的折旧和摊销情况如下：

单位：万元

项目	折旧年限	折旧和摊销金额		
		第1年	第2年	第3年及以后

项目	折旧年限	折旧和摊销金额		
		第 1 年	第 2 年	第 3 年及以后
房屋及建筑物	20 年	425.00	1015.00	1015.00
机器设备	5 年	-	814.16	814.16
合计		425.00	1,829.16	1,829.16

（四）说明募投项目用地的计划、取得土地的具体安排、进度，如无法取得募投项目用地拟采取的替代措施以及对募投项目实施的影响等

（1）微波电子元器件生产基地建设项目

①本项目建设用地的计划、取得土地的具体安排、进度

本项目建设地点为湖南省株洲市高新技术产业开发区天易科技城 K2 地块。2020 年 9 月 1 日，发行人与株洲天易建设发展有限公司签订《天易科技城自主创业园厂房买卖合同》，约定发行人向株洲天易建设发展有限公司购买天易科技城 K2 地块 3、4、5、6 号四栋标准厂房。

就上述厂房所在地块卖方株洲天易建设发展有限公司通过国有土地使用权挂牌出让方式已取得土地使用权，并依法进行土地使用权使用登记取得土地使用权证。根据上述买卖合同约定，发行人向卖方的付款方式为分三期付款，在付清全款后 3 个月内将办理不动产权证过户，其中第一期款项已完成支付，截至本回复报告签署日，发行人尚未付清全款，从而尚未办理不动产权证过户并取得相关产权证书。

②株洲天易建设发展有限公司基本情况

株洲天易建设发展有限公司为微波电子元器件生产基地建设项目建设地点相关厂房的开发商，其主要业务为株洲高新技术产业开发区内相关产业园区的开发和建设，基本情况如下：

项目	具体内容
公司名称	株洲天易建设发展有限公司
成立时间	2014 年 4 月 18 日
控股股东	湖南天易集团有限公司
实际控制人	株洲高新技术产业开发区管理委员会

项目	具体内容
经营范围	房地产开发经营；房屋建筑工程施工；市政工程施工；物业管理；园林绿化工程施工；钢结构工程施工。

③发行人取得相关产权证书不存在障碍

发行人目前已取得卖方株洲天易建设发展有限公司出具的专项说明文件，说明发行人根据买卖合同妥善履行全部合同约定义务，不存在任何违反合同约定的违约行为，并在买卖合同约定的办理房产权证书条件达成之日，协助发行人办理取得上述厂房的产权证书。2021年8月12日，株洲市天元区自然资源局出具专项证明，说明发行人购买的上述地块待全部厂房建设完成后将办理产权证书。发行人将在付清全款后，及时办理不动产权证过户并取得相关产权证书，确保项目整体进度不受影响。

(2) 研发中心建设项目

本项目建设地点为成都市双流区军民融合产业园（四川省成都市双流区东升街道永乐村五、六组，九江街道蛟龙社区七组），发行人已取得相关土地使用权证，土地证号为“川（2021）双流区不动产权第0006680号”。

二、补充披露内容

针对本次募投项目相关风险，发行人已在募集说明书之“重大事项提示”及“第六节 与本次发行相关的风险因素”之“五、募投项目相关风险”补充披露内容如下：

“（一）募投项目实施进度风险

截至本募集说明书签署日，发行人“微波电子元器件生产基地建设项目”的建设地尚未办理不动产权证过户并取得相关产权证书。如果发行人一直未能取得产权证书，可能对募投项目实施的整体进度造成一定影响。此外，随着公司相关产品产能的扩张，公司的资产规模及业务复杂度将进一步提升，研发、运营和管理人员将相应增加，如果公司未能根据业务发展状况及时提升人力资源、法律、财务等方面的管理能力，可能会影响项目研发及建设进程，导致项目未能按期投入运营的风险。

（二）募投项目收益未达预期的风险

本次募集资金拟用于的项目包括微波电子元器件生产基地建设项目、研发中心建设项目和补充流动资金。虽然公司对本次募集资金投资项目均进行了审慎的可行性论证和充分的市场调查，但在募投项目的实施过程中，公司面临行业发展变化、市场竞争变化、高可靠单位验证周期变化等多重不确定性，可能对实现预期收益的前提条件产生不利影响。此外，如本次募投项目的成本费用无法有效控制，或者公司未能按既定计划完成募投项目，可能会影响募投项目的投资成本、投资回收期、投资收益率等，从而可能导致募集资金投资项目的实际效益与预期存在一定的差异。

（三）募投项目新增产能消化的风险

本次募投项目中，微波电子元器件生产基地建设项目将新增陶瓷电容器产能200,000万只/年，新增环行器及隔离器产能150万只/年，新增产能均可用于高可靠产品和民用产品。在高可靠领域，发行人已与众多高可靠领域集团签订正式协议；在民用领域，发行人现有或潜在客户的需求量较大，但受限于产能不足，尚无法满足相关民用客户的大批量需求，因而尚未签署正式业务协议。通过本次募投项目的实施将有利于缓解现有产能瓶颈，提高产品质量，丰富产品结构，保障企业持续高水平发展。但上述募投项目的必要性和可行性分析是基于当前宏观经济环境、产业发展趋势、市场整体供求关系及公司未来发展战略等因素作出的判断。未来募投项目建设完成并投入实施后，如果行业政策、市场需求和技术发展等方面发生不利变化，将对公司实施募投项目产生不利影响，且如果未来民用产品市场拓展不及预期，可能导致募集资金投资项目投产后新增产能无法及时消化，从而对公司经营业绩产生不利影响。

（四）募投项目新增固定资产折旧和摊销的风险

发行人按照当前执行的折旧与摊销政策，对本次募投项目新增固定资产进行折旧和摊销。微波电子元器件生产基地建设项目预计建成后的年均折旧和摊销金额为7,925.89万元，研发中心建设项目预计建成后的年均折旧和摊销金额为1,829.16万元，合计占公司最近三年平均营业收入的10.16%，可能存在因资产折旧增加导致公司经营业绩受到不利影响的风险。”

三、核查程序

保荐机构、会计师执行了如下核查程序：

1、取得本次募投项目相关的可行性研究报告、效益测算明细表，了解本次募投项目的投资规模及其合理性、必要性，以及本次募投项目的建设进度、预计达产时间、预计产生收入情况、固定资产投资情况等；

2、查阅陶瓷电容器、环形器及隔离器相关的行业研究报告、同行业可比公司的公开披露资料，了解相关行业的发展情况和竞争格局等；

3、对发行人相关财务人员、销售人员进行访谈，了解相关产品的现有客户及收入情况，潜在客户及需求情况；

4、查阅发行人报告期内的年度报告、财务报表以及相关产品的收入明细表，核查相关产品的单价、单位成本和毛利率等情况，并与本次募投项目效益测算明细表中相关产品的关键参数进行对比分析；

5、取得发行人出具的《前次募集资金使用情况专项报告》，以及众华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《前次募集资金使用情况鉴证报告》，了解前次募投项目的建设进度情况和前次募集资金使用情况；

6、对发行人相关管理人员进行访谈，了解本次募投项目建设用地情况，查阅成都市双流区军民融合产业园相关土地证书、株洲天易建设发展有限公司出具的专项说明文件以及株洲市天元区自然资源局出具的专项证明。

四、核查意见

经核查，保荐机构、会计师认为：

1、发行人本次募投项目相关产品下游市场空间较大且持续增长，下游各类客户需求量充足，且发行人深耕高可靠领域多年已在技术和工艺、客户关系、资质与认证、营销渠道和销售体系方面形成了较强的竞争优势，因此本次募投项目投资规模具有合理性和必要性；

2、发行人本次募投项目预计效益测算依据充分，测算过程合理，关键性参数合理、谨慎，并已充分考虑高可靠单位验证周期的影响；

3、发行人前次募投项目已全部建设完毕，募集资金已全部使用，本次募投

项目建设预计新增相关资产的折旧和摊销已在效益测算中充分考虑；

4、本次募投项目中，研发中心建设项目建设用地已取得产权证书，微波电子元器件生产基地建设项目相关产权证书尚未取得，根据株洲天易建设发展有限公司已取得的土地使用权证并出具的专项说明文件以及株洲市天元区自然资源局出具专项证明，预计取得相关产权证书不存在实质性障碍。发行人将在付清全款后，及时办理不动产权证过户并取得相关产权证书，确保项目整体进度不受影响；

5、发行人已在募集说明书中补充披露上述问题所涉及的相关风险。

问题六

发行人拟使用募集资金 1.8 亿元投向研发中心建设项目（以下简称“研发中心项目”）。项目投资测算构成中包含研发人员及其他费用 3000 万元，其中拟使用募集资金投入 1600 万元。本次募投研发中心项目建设地在成都，由全资子公司成都宏电科技有限公司（以下简称“成都宏电”）实施，2020 年净利润为-158.83 万元。此外，发行人首次公开发行募投研发中心建设项目已经于 2019 年 10 月 28 日达到预定可使用状态，使用募集资金投入 5,000 万元，该项目建设地在株洲，由发行人实施。

请发行人补充说明：（1）结合前募研发中心项目的主要开支测算情况，说明本次募投研发中心项目投资规模的合理性，研发人员及其他费用支出的主要用途及金额测算的谨慎性；（2）结合现有研发中心及研发业务主要内容、研发及生产区域分布情况、现有及预计新增研发人员情况、未来研发人员安排情况、新建研发中心与现有研发中心在研发内容上的区别与联系，说明研发基地项目能否与现有研发生产业务形成协同，是否存在重复建设的情形；（3）请用简明清晰、通俗易懂的语言说明本次研发内容拟实现的研发成果及主要应用领域，说明其研发难点及与发行人现有主营业务的联系，并结合下游需求、市场竞争情况、成都宏电技术与人才储备等充分论证其可行性；（4）结合报告期内研发费用支出、研发场地支出情况、本次研发基地新增研发场地支出金额及占比情况等、相关研发项目预期投入情况等，说明新建研发基地未来是否存在大幅增加研发支出的情形，该研发基地是否超出现有研发所需。

请发行人补充披露（3）（4）相关的风险。

请保荐人和会计师核查并发表明确意见。

回复：

一、对问题的回复

（一）结合前募研发中心项目的主要开支测算情况，说明本次募投研发中心项目投资规模的合理性，研发人员及其他费用支出的主要用途及金额测算的谨慎性

1、前次募投项目中研发中心项目的主要开支测算情况

发行人前次募投项目中研发中心项目的主要开支测算情况如下：

单位：万元

序号	投资项目	投资金额	占比
1	建筑工程费用	1,061.00	21.22%
2	研发设备投入	2,587.79	51.76%
3	研发人员及其他费用	1,250.00	25.00%
4	项目预备费	101.21	2.02%
合计		5,000.00	100.00%

2、本次募投项目中研发中心建设项目投资规模的合理性

本次研发中心建设项目的主要开支测算情况如下：

单位：万元

序号	投资项目	投资金额	占比	拟投入募集资金
1	工程建设投入	11,800.00	57.84%	11,800.00
1.1	研发场地建设施工	8,500.00	41.67%	8,500.00
1.2	研发场地装修	3,100.00	15.20%	3,100.00
1.3	环保投入	200.00	0.98%	200.00
2	研发设备投入	4,600.00	22.55%	4,600.00
3	研发人员及其他费用	3,000.00	14.71%	1,600.00
4	铺底流动资金	1,000.00	4.90%	-
合计		20,400.00	100.00%	18,000.00

如上表所示，本次研发中心建设项目投资总额为 20,400.00 万元，高于前次募投项目的研发中心投资总额，主要原因包括：①本次研发中心建设项目拟在成都新建研发场地，前次募投项目研发中心系原有场地的更新改造；②本次研发中心建设项目涉及的研发内容为新产品和前沿技术，需引入的先进研发设备和高技

术研发人员较多，前次募投项目研发中心主要方向为较为成熟的钽电容产品，所需的研发设备和研发人员相对较少。

(1) 研发场地工程建设投入的合理性

本次研发中心建设项目总建筑面积为 25,840 平方米，拟新建新产品研发线、实验和检测线、研发办公场所、研发配套用房等，建设施工投入为 8,500.00 万元，装修投入为 3,100.00 万元，环保投入 200.00 万元，工程建设投入合计 11,800.00 万元。发行人本次研发中心建设项目工程建设投入与成都其他拟上市公司比较情况如下：

公司名称	项目名称	工程建设投入金额 (万元)	建设面积 (m ²)	建设单价 (元/m ²)
成都思科瑞微电子股份有限公司	成都检测试验基地建设项目	6,806.87	13,333.34	5,105.15
成都国光电气股份有限公司	科研生产综合楼及空天通信技术研发中心建设项目	15,134.55	36,510.00	4,145.32
宏达电子	研发中心建设项目	11,800.00	25,840.00	4,566.56

资料来源：公司招股说明书、募集说明书等

如上表所示，发行人本次研发中心建设项目总投入 11,800.00 万元，建设面积为 25,840 平方米，建设单价为 4,566.56 元/平方米，与成都其他拟上市公司相关项目的建设单价和建设规模不存在重大差异。

(2) 研发设备投入的合理性

本次研发中心建设项目，研发设备投入金额为 4,600.00 万元，具体如下：

单位：万元

序号	设备名称	设备数量	设备金额
1	矢量网络分析扩频模块	1	400.00
2	SMT 多功能贴片机	1	300.00
3	高速示波器	5	300.00
4	频谱仪	5	300.00
5	表面处理线	1	291.00
6	高低温快变试验箱	10	280.00
5	微组装用自动键合机	1	250.00
8	信号发生器	5	250.00

序号	设备名称	设备数量	设备金额
9	SMT 生产线用 AOI	2	200.00
10	测试机	20	160.00
11	高低温冲击试验箱	5	160.00
12	SMT 生产线用 X-Ray	1	150.00
13	微组装用自动贴片机	1	150.00
14	贴膜机	4	140.00
15	划片机	4	120.00
16	高低温箱	10	120.00
17	多功能振动台	1	100.00
18	功率试验系统	1	81.00
19	功率计	5	80.00
20	频谱仪	3	75.00
21	探针台	1	70.00
22	高速振动机	1	70.00
23	X 光射线测厚仪	1	60.00
24	信号源	4	52.00
25	SMT 生产线用 SPI	1	50.00
26	高温箱	10	40.00
27	光学检查仪	1	30.00
28	平整度测试仪	1	30.00
29	交变/恒定湿热试验箱	5	30.00
30	拉力剪切力测试仪	1	30.00
31	超声波清洗设备	1	29.00
32	高低温低气压试验箱	1	25.00
33	低温箱	2	24.00
34	纯水机组	1	20.00
35	防潮柜	10	20.00
36	冷水机	5	20.00
37	箱式转臂稳态加速度试验机	1	14.00
38	氦气氟油加压检漏装置	1	12.00
39	密封检漏台	1	12.00
40	氦校准漏孔	1	10.00
41	霉菌试验箱	1	10.00

序号	设备名称	设备数量	设备金额
42	SMT 自动上板/收板系统	1	8.00
43	线宽测试仪	1	6.00
44	图像显微镜	2	6.00
45	示波器	4	4.00
46	氦质谱检漏仪	1	4.00
47	盐雾试验箱	1	4.00
48	大功率电源	10	3.00
合计		157	4,600.00

如上表所示，发行人根据本次研发中心建设项目相关新产品和新技术研发所需的相关设备数量和价格进行预测，研发设备投入合计为 4,600.00 万元。

(3) 研发人员及其他费用投入的合理性

本次研发中心建设项目拟投入的研发人员薪酬为 2,700.00 万元，包含相关人员两年的薪酬总和；拟投入研发材料费、培训费等 300.00 万元。报告期内，发行人研发人员薪酬、数量与本次研发中心建设项目比较情况如下：

单位：万元

项目	本项目	2021 年 1-6 月	2020 年度	2019 年度	2018 年度
薪酬	1,350.00	2,115.69	2,622.12	1,841.52	1,979.16
人数	110	298	168	99	77
平均薪酬	12.27	7.10	15.61	18.60	25.70

注：2021 年 1-6 月的平均薪酬未年化处理。本项目拟投入 2,700 万元包含两年的薪酬。

如上表所示，报告期内，随着收入规模的逐年增长和业务范围的逐步扩张，发行人研发人员数量逐年大幅上升趋势，研发人员平均薪酬略有下降，主要系新入职研发人员职级较低，薪酬相对较低所致。

本次研发中心建设项目将根据研发任务需要，引入 110 名各层级的研发人员，平均薪酬约为 12.27 万元，较报告期内发行人平均薪酬水平预测较为谨慎。

此外，除研发人员薪酬外，发行人拟投入 300.00 万元用于研发活动所需的材料费、培训费等，相关费用金额较小。

综上所述，本次研发中心建设项目投入规模具有合理性。

3、本次研发中心建设项目中研发人员及其他费用支出情况

①研发人员支出具体情况

单位：万元

序号	职务	数量	未来2年薪酬	平均年薪
1	研发管理人员	2	120.00	30.00
2	高级工程师	8	480.00	30.00
3	中级工程师	15	600.00	20.00
4	初级工程师	40	800.00	10.00
5	研发试验人员	40	640.00	8.00
6	研发辅助人员	5	60.00	6.00
合计		110	2,700.00	12.27

如上表所示，发行人根据本次研发中心建设项目人员需求和预计年薪水平，投入相关研发人员费用，预计未来2年薪酬合计为2,700.00万元，平均年薪为12.27万元，较报告期内发行人平均薪酬水平预测较为谨慎。

②其他费用支出具体情况

发行人其他费用支出为300.00万元，具体如下：

单位：万元

序号	项目	金额
1	研发材料费用	270.00
2	研发培训费用	30.00
合计		300.00

发行人研发中心建设项目少量其他费用支出主要为研发材料和培训费用。

(二) 结合现有研发中心及研发业务主要内容、研发及生产区域分布情况、现有及预计新增研发人员情况、未来研发人员安排情况、新建研发中心与现有研发中心在研发内容上的区别与联系，说明研发基地项目能否与现有研发生产业务形成协同，是否存在重复建设的情形

1、现有研发中心及研发业务的主要内容

发行人现有研发中心及研发业务以电子元器件和电路模块为主，包括钽电容器、铝电容器、陶瓷电容器、薄膜电容器、电感器、电阻、环形器及隔离器、LTCC 器件、电源微电路模块、惯性微电路等。

2、发行人研发及生产区域分布情况

发行人现有研发及生产区域包括株洲、成都、深圳以及西安，具体如下：

序号	区域	功能	具体内容
1	株洲	研发、生产	钽电容器、铝解电容器、陶瓷电容器、薄膜电容器、电感器、电阻、环形器及隔离器、LTCC 器件、电源微电路模块的研发和生产，以及电子元器件的性能检测、环境试验等
2	成都	研发、生产	射频模块的研发和生产，嵌入式板卡的前期研发
3	深圳	研发	电源微电路模块的研发
4	西安	研发	电源微电路模块的研发

3、发行现有及预计新增研发人员情况及未来研发人员安排

报告期各期末，发行人研发人员数量分别为 77 人、99 人、168 人和 298 人，主要针对现有产品和技术开展研发工作。

本次研发中心建设项目实施后，预计将在成都地区新增 110 名研发人员，主要针对超宽带嵌入式板卡及其相关的配套电子元器件开展研发工作，具体人员安排详见本问题回复第一部分。

4、新建研发中心与现有研发中心在研发内容上的区别与联系

(1) 新建研发中心与现有研发中心在研发内容上的区别

本次新建研发中心的研发方向主要为超宽带嵌入式板卡及其相关的配套电子元器件；现有研发中心的研发内容则主要以电子元器件和电路模块为主，包括钽电容器、铝电容器、陶瓷电容器、薄膜电容器、电感器、电阻、环形器及隔离

器、LTCC 器件、电源微电路模块、惯性微电路等。

（2）新建研发中心与现有研发中心在研发内容上的联系

发行人新建研发中心项目主要围绕超宽带嵌入式板卡展开，发行人现有钽电容器、铝电容器、陶瓷电容器、电感器、电阻器等电子元器件均为嵌入式板卡的上游原材料。

5、本次研发中心建设项目与发行人现有业务具有协同效应，不存在重复建设的情形

根据前文分析，发行人本次研发中心建设项目的研发方向主要为超宽带嵌入式板卡及其相关的配套电子元器件，与现有研发中心内容存在明显区别，不存在重复建设的情形；此外，发行人现有电子元器件产品为嵌入式板卡的上游原材料，因此，本次研发中心建设项目与发行人现有业务具有协同效应。

（三）请用简明清晰、通俗易懂的语言说明本次研发内容拟实现的研发成果及主要应用领域，说明其研发难点及与发行人现有主营业务的联系，并结合下游需求、市场竞争情况、成都宏电技术与人才储备等充分论证其可行性

1、本次研发中心建设项目的的主要内容、拟形成的研发成果及主要应用领域

发行人本次研发中心建设项目主要内容为超宽带嵌入式板卡及其相关的配套电子元器件，未来将形成超宽带嵌入式板卡相关的一系列核心技术，从而具备相关产品的研发、设计和生产能力。

嵌入式板卡主要由嵌入式软件以及承载嵌入式软件的硬件组成，通常以模块、插件或设备形式嵌入到装备系统内部，使得装备系统具备智能完成各项任务的功能，被广泛应用于装备控制、指挥控制、通信系统仿真等领域，可通过智能化替代人工操作完成侦察、通信、搜索、识别等功能。

2、本次研发难点及与发行人现有主营业务的联系

（1）研发难点

①嵌入式数据处理技术：采用多处理器协同并行处理、任务分布式计算、高性能缓存管理、高可靠性热设计等技术解决以往单处理器性能不足、任务切换频繁、缓存效率低的缺点，提高装备中嵌入式计算机模块的数据处理能力以及装备

的效能。

②多总线交换技术：采用嵌入式多协议高速总线交换管理技术，实现多协议总线交换，充分发挥各嵌入式协议总线的高速通信能力，解决装备各子系统间通信带宽低的技术难题。

③中频射频数据采集技术：中频射频采集技术，既能满足射频直采所需的超大带宽要求，也能解决高精度、高可靠性、高同步性等设计难题。同时，通过专用结构工艺设计，可解决体积、散热、振动等适应性问题，满足未来各类装备中软件应用需求。

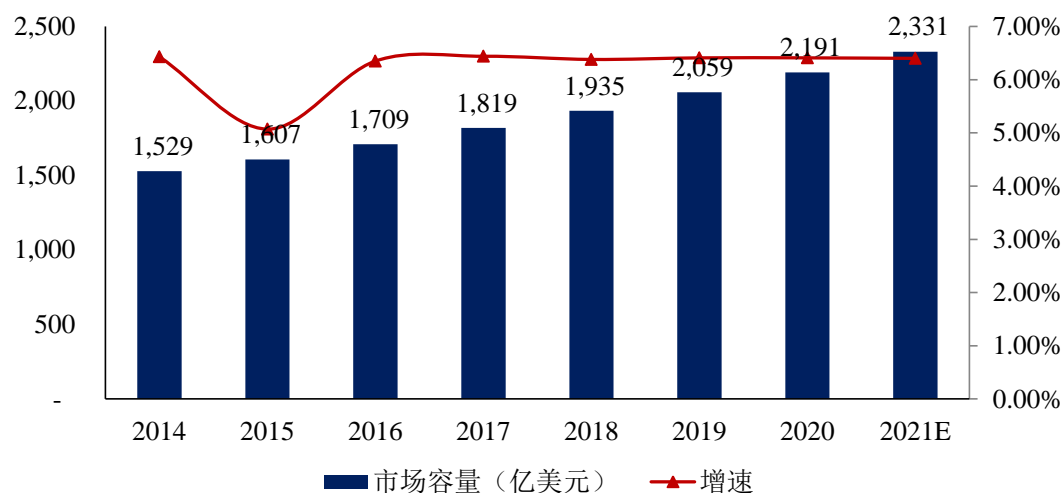
（2）与发行人现有主营业务的联系

发行人现有电子元器件产品为嵌入式板卡的上游原材料。发行人深耕高可靠领域多年，积累了大量高可靠电子元器件的核心技术，电子元器件的可靠性是嵌入式板卡有效运行的关键，发行人已有的高可靠电子元器件相关核心技术系本次研发中心建设项目的重要基础。

3、本次本次研发中心建设项目的可行性

（1）下游需求情况

近年来，工业控制、消费电子、通信设备、安防监控、高可靠等领域智能化程度的提升拉动了嵌入式板卡的市场需求，根据 Transparency Market Research 数据，2021 年，全球嵌入式板卡市场容量将达到 2,331 亿美元，具体如下：



数据来源：Transparency Market Research

随着各行业信息化、智能化的快速发展，各类智能终端设备的需求将进一步提升，嵌入式板卡作为智能终端设备的核心配件之一，将被应用到更多领域，未来市场需求将持续提升。

(2) 市场竞争情况

国内嵌入式板卡主要生产厂商情况如下：

公司名称	业务简介
雷科防务 (002413.SZ)	主要从事嵌入式实时信息处理、复杂电磁环境测试与验证及评估、北斗卫星导航接收机、雷达及微波信息分配管理及接收处理业务
景嘉微 (300474.SZ)	主要产品包括嵌入式图形板卡、单板计算机、加固电子产品、集成电路及微波射频等
中科海讯 (300810.SZ)	主要业务为信号处理平台、声呐系统、水声大数据与仿真系统、无人探测系统等
智明达 (688636.SH)	主要面向高可靠领域客户，提供嵌入式计算机相关产品和解决方案

资料来源：公司官网

(3) 发行人技术与人才储备情况

①技术储备

发行人及其控股子公司目前已拥有嵌入式板卡相关的软件著作权如下：

序号	软件名称	登记号	登记日期	取得方式
1	HD-V1-BFT2000 操作系统软件	2021SR0066793	2021.01.13	原始取得
2	HD-CSP2020 平台软件	2020SR1037494	2020.09.03	原始取得
3	HD-P2020 平台软件	2020SR1038270	2020.09.03	原始取得
4	HD-N1 控制器软件	2020SR0324427	2020.04.10	原始取得
5	CAMERALINK 信号处理模块软件	2019SR1200725	2019.11.23	原始取得
6	HD-BP2020-C1 主控插件软件	2019SR1186763	2019.11.21	原始取得
7	HD-BZ7015X-K2 1480 综合控制单元软件	2019SR1160022	2019.11.15	原始取得
8	CPU-34F 嵌入式导航计算机板控制软件	2019SR1150592	2019.11.14	原始取得
9	HD-E1 数据记录仪控制软件	2019SR1153969	2019.11.14	原始取得
10	HD-E2-BIMX6Q ARM 控制模块软件	2019SR1148328	2019.11.13	原始取得
11	HD-K3 综控板控制软件	2019SR1132752	2019.11.09	原始取得
12	P1010 系列计算机电路软件	2019SR0795803	2019.07.31	原始取得

序号	软件名称	登记号	登记日期	取得方式
13	国产通用信号处理板控制软件	2019SR0714966	2019.07.11	原始取得
14	通用总线自动测试软件	2019SR0646068	2019.06.24	原始取得
15	嵌入式导航计算机板控制软件	2018SR842588	2018.10.32	原始取得
16	整机设备自动化测试信息采集管理系统	2020SR1584587	2020.11.16	原始取得
17	整机设备接收变频自动测试管理系统	2020SR1584542	2020.11.16	原始取得
18	微波芯片应用范围智能化查询系统	2020SR1584543	2020.11.16	原始取得
19	微波芯片外观结构设计应用系统	2020SR1584534	2020.11.16	原始取得
20	接口线缆定制式工艺测评系统	2020SR1584677	2020.11.16	原始取得
21	微波芯片技术开发文件管理系统	2020SR1584439	2020.11.16	原始取得
22	微波芯片产品生产质量检测服务平台	2020SR1584532	2020.11.16	原始取得
23	微波芯片产品开发文件资料管理系统	2020SR1584533	2020.11.16	原始取得
24	加固计算机效果性能测评管理系统	2020SR1584671	2020.11.16	原始取得
25	国产化射频微波芯片研发测试综合管理系统	2020SR1584531	2020.11.16	原始取得

②人员储备

截至 2021 年 6 月 30 日，发行人成都地区研发人员数量为 32 人，覆盖逻辑系统设计、硬件设计、软件系统设计、电路设计、工艺工程等专业领域人才，具体情况如下：

层级	平均从业年限（年）	人数
高级工程师	8.45	16
中级工程师	7.37	8
初级工程师	3.66	8
合计		32

此外，本项目的建设地点成都是国内最主要的电子产业聚集区域之一，区域附近拥有丰富的产业资源及人才资源，有助于公司吸引人才，获得充分的技术支持，从而提升公司人才优势、研发实力。

综上所述，发行人本次研发中心建设项目主要内容为超宽带嵌入式板卡及其相关的配套电子元器件，未来将形成超宽带嵌入式板卡相关的一系列核心技术，

从而具备相关产品的设计和生产能力，系发行人开拓新品、向产业链下游延伸、保持市场竞争力的重要举措。相关产品符合信息化、智能化的行业发展趋势，下游市场需求广阔。同时，发行人深耕高可靠领域多年，积累了大量高可靠电子元器件的核心技术，为本次研发中心建设项目的重要基础。因此，本次研发中心建设项目具有实施的可行性。

（四）结合报告期内研发费用支出、研发场地支出情况、本次研发基地新增研发场地支出金额及占比情况等、相关研发项目预期投入情况等，说明新建研发基地未来是否存在大幅增加研发支出的情形，该研发基地是否超出现有研发所需

1、报告期内研发费用支出情况

报告期内，发行人研发费用支出情况如下：

项目	2021年1-6月	2020年度	2019年度	2018年度
研发投入金额（万元）	4,731.95	8,393.70	5,692.45	4,293.40
研发投入占营业收入比例	5.13%	5.99%	6.74%	6.75%

2、报告期内研发场地情况

报告期内，发行人研发场地情况如下：

位置	性质	地址	面积（m ² ）	研发内容
株洲	自有	天元区规划五区3号楼2层，6号楼5层和6层	2,950.00	钽电容器、铝电容器、陶瓷电容器、薄膜电容器、电感器、电阻、环形器及隔离器、LTCC器件等
深圳	租赁	深圳市南山区街道前海路泛海城市广场2栋1004	234.70	电源模块
西安	租赁	陕西省西安市高新区天谷七路88号新加坡腾飞科汇城东楼九层902和903单元	349.00	电源模块
成都	租赁	成都市武侯区武青西四路3号2栋7楼701号房	960.78	嵌入式板卡及相关软件
	租赁	高新西区天映路11号3栋9层901-903号	614.02	射频模块

如上表所示，发行人研发场地除株洲为自有外，其余地区均为租赁。成都地区是发行人未来重点发展区域，相关产品亦为重点发展方向，本次研发中心建设项目在成都地区新建自有研发场所，有利于更好的吸引高端人才，进一步加强发行人研发实力。

3、本次研发中心建设项目新增研发场地支出金额及占比情况

本次研发中心建设项目新增研发场地支出包括 8,500.00 万元研发场地建设施工费用、3,100.00 万元研发场地装修费用以及 200.00 万元环保支出费用，合计为 11,800.00 万元，占本项目投入金额的 57.84%。

4、相关研发项目预计投入情况

本次研发中心建设项目建成后，预计每年增加的研发支出情况如下：

单位：万元

序号	项目	金额
1	房屋建筑物折旧	1,015.00
2	研发设备折旧	814.16
3	研发人员薪酬	1,350.00
4	研发材料及其他费用	150.00
	合计	3,329.16

5、新建研发中心未来不存在大幅增加研发支出的情形，该研发中心与未来研发需求相匹配

根据前文所述，发行人新建研发中心预计未来每年将增加研发费用 3,329.16 万元，按照 2020 年度营业收入和利润总额测算，占营业收入的比例为 2.38%，占利润总额的比例为 5.40%，对发行人利润总额影响较小。

此外，本次研发中心建设项目的实施将有利于发行人开拓新产品、新技术和新工艺，从而实现持续的技术创新，增强发行人技术实力和核心竞争力，为发行人未来进一步发展及经营业绩的持续提高奠定坚实基础。

二、补充披露内容

针对本次募投项目相关风险，发行人已在募集说明书之“重大事项提示”及

“第六节 与本次发行相关的风险因素”之“五、募投项目相关风险”补充披露内容如下：

“（五）募投项目研发失败的风险”

公司下游的高可靠领域，以及通信、消费电子、汽车电子和工业装备等行业均为高新技术领域。下游行业的技术快速更迭，使得公司等上游电子元器件和电路模块供应商需不断更新和适应新技术的发展，准确把握市场和客户需求变化，适时布局新产品，不断研发新工艺。本次募投项目之研发中心建设项目实施后，公司每年研发投入支出将存在一定幅度的提升，将对当期业绩产生影响。

此外，本次募投项目建设的超宽带嵌入式板卡相关产品技术壁垒相对较高、研发难度较大，需要一定的技术和研发人才储备。如果公司出现人才流失，或者无法突破研发难点的情形，则可能导致研发失败，将会对公司的经营情况产生一定的不利影响。”

三、核查程序

保荐机构、会计师执行了如下核查程序：

- 1、查阅发行人前次募投项目研发中心项目的可行性研究报告，了解研发中心项目主要开支测算情况，以及现有研发中心的主要研发内容等；
- 2、查阅发行人本次研发中心建设项目的可行性研究报告和投入明细表，了解本次研发中心建设项目的研发内容及应用领域，研发人员及其他费用支出用途、测算依据等；
- 3、查阅相关行业研究报告和发行人年度报告，了解相关产品下游需求情况和市场竞争情况，以及发行人现有的人才和技术储备情况；
- 4、查阅发行人年度报告，并与本次研发中心建设项目可行性研究报告进行对比分析，了解本次研发中心建设项目与发行人现有业务的区别和联系，核查报告期内和本次研发中心建设项目的研发费用支出、研发场地相关情况。

四、核查意见

经核查，保荐机构、会计师认为：

- 1、本次研发中心建设项目投资规模较为合理，研发人员及其他费用支出预

测较为谨慎；

2、本次研发中心建设项目与发行人现有研发和生产业务具有协同效应，不存在重复建设的情况；

3、本次研发中心建设项目具有实施的可行性；

4、本次研发中心建设项目预计将增加一定的研发支出，但对发行人利润总额影响较小，且本次研发中心建设项目的实施将有利于增强发行人技术实力和核心竞争力，为发行人未来进一步发展及经营业绩的持续提高奠定坚实基础；

5、发行人已在募集说明书中补充披露上述问题所涉及的相关风险。

问题七

截至 2021 年 6 月末，交易性金融资产为 2,085.55 万元，长期股权投资为 725.15 万元，主要为持有展芯半导体 48.58%的股权和持有宏讯微电子 35.00%的股权；其他非流动金融资产为 500 万元，主要为持有株洲县融兴村镇银行 10%股权；投资性房地产为 17.84 万元。本次拟使用募集资金 2 亿元用于补充流动资金。

请发行人补充说明：（1）最近一期末对外投资情况，包括公司名称、认缴金额、实缴金额、初始及后续投资时点、持股比例、账面价值、占最近一期末归母净资产比例、是否属于财务性投资；（2）详细论证被投资企业与发行人主营业务是否密切相关，结合投资后新取得的行业资源或新增客户、订单，以及报告期内被投资企业主要财务数据情况等，说明发行人是否有能力通过该投资有效协同行业上下游资源以达到战略整合或拓展主业的目的，或仅为获取稳定的财务性收益；（3）自本次发行相关董事会前六个月至今，公司已实施或拟实施的财务性投资的具体情况；（4）结合营运资金及缺口情况、闲置资金管理情况、未来投资安排等，说明补充流动资金的必要性。

请保荐人和会计师核查并发表明确意见。

回复：

一、对问题的回复

（一）最近一期末对外投资情况，包括公司名称、认缴金额、实缴金额、初始及后续投资时点、持股比例、账面价值、占最近一期末归母净资产比例、是否属于财务性投资

1、财务性投资的相关认定标准

根据中国证监会《关于上市公司监管指引第 2 号——有关财务性投资认定的问答》的规定：财务性投资除监管指引中已明确的持有交易性金融资产和可供出售金融资产、借予他人、委托理财等情形外，对于上市公司投资于产业基金以及其他类似基金或产品的，如同时属于以下情形的，应认定为财务性投资：（1）上市公司为有限合伙人或其投资身份类似于有限合伙人，不具有该基金（产品）的

实际管理权或控制权；（2）上市公司以获取该基金（产品）或其投资项目的投资收益为主要目的。

根据《创业板上市公司证券发行上市审核问答（2020）》问题 10 的规定：（1）财务性投资的类型包括不限于：类金融；投资产业基金、并购基金；拆借资金；委托贷款；以超过集团持股比例向集团财务公司出资或增资；购买收益波动大且风险较高的金融产品；非金融企业投资金融业务等。（2）围绕产业链上下游以获取技术、原料或渠道为目的的产业投资，以收购或整合为目的的并购投资，以拓展客户、渠道为目的的委托贷款，如符合公司主营业务及战略发展方向，不界定为财务性投资。

2、发行人最近一期末对外投资情况

截至 2021 年 6 月 30 日，发行人最近一期末对外投资情况如下：

单位：万元

公司名称	认缴金额	实缴金额	初始投资时点	后续投资时点	持股比例	账面价值	占最近一期末归母净资产比例	是否属于财务性投资
展芯半导体	272.04	272.04	2015-12	2017-6、 2019-10	48.58%	172.01	0.07%	否
宏讯微电子	700.00	700.00	2020-5	2020-5、 2020-7	35.00%	456.20	0.19%	否
芯瓷电子	450.00	100.00	2021-6	-	45.00%	96.95	0.04%	否
株洲县融兴村镇银行	550.00	550.00	2011-5	2015-12	10.00%	500.00	0.20%	是

注：投资时点以实际出资时间为准。

如上表所示，除对株洲融兴村镇银行的投资属于财务性投资外，其余被投资企业均系发行人不断探索新的业务发展方向，持续开拓产品品类，基于高可靠电子元器件产业上下游产业链资源整合而进行的对外投资，与发行人主营业务密切相关，不属于财务性投资。

除上述四家企业外，2021年8月，发行人参与投资设立君民电子，主要经营插件钽电容器的研发、生产和销售，亦不属于财务性投资。截至本回复报告签署日，发行人认缴出资70.00万元，实缴出资0.00万元，持股比例为35.00%。

(二) 详细论证被投资企业与发行人主营业务是否密切相关, 结合投资后新取得的行业资源或新增客户、订单, 以及报告期内被投资企业主要财务数据情况等, 说明发行人是否有能力通过该投资有效协同行业上下游资源以达到战略整合或拓展主业的目的, 或仅为获取稳定的财务性收益

截至本回复报告签署日, 发行人共对 5 家企业进行投资, 分别为展芯半导体, 宏讯微电子、芯瓷电子、君民电子和株洲融兴村镇银行, 其中, 对株洲融兴村镇银行的投资属于财务性投资, 其余四家企业均系发行人不断探索新的业务发展方向, 持续开拓产品品类, 基于高可靠电子元器件产业上下游产业链资源整合而进行的对外投资, 与发行人主营业务密切相关, 不属于财务性投资。

1、被投资企业相关业务与发行人主营业务的关联性

上述被投资企业主要业务及与发行人主营业务的关联性如下:

序号	公司名称	主要业务	与发行人主营业务的关联性
1	展芯半导体	主要经营半导体芯片的设计、研发、生产和销售	随着高可靠领域客户对半导体芯片的需求提升, 发行人投资展芯半导体, 以满足部分客户对相关产品的需求
2	宏讯微电子	主要经营微波射频组件等电子元器件, 产品广泛用于雷达、基站等通信系统	随着新一代信息技术的快速发展, 下游市场对微波电子元器件的需求持续上升, 发行人通过投资宏讯微电子, 提升相关产品的技术水平, 满足下游客户的需求增长
3	芯瓷电子	主要经营陶瓷制品的生产、研发和销售, 主要产品包括陶瓷材料、陶瓷结构件等	发行人陶瓷电容器收入持续提升, 芯瓷电子专注于陶瓷材料和陶瓷结构件研发, 有利于提升发行人陶瓷电容器的产品性能
4	君民电子	主要经营插件钽电容器的研发、生产和销售	君民电子主要从事部分个性化型号钽电容的研发和生产, 用于满足下游民用客户传统型号的需求
5	株洲融兴村镇银行	主要经营吸收存款、发放贷款、银行卡等经银行业监督管理机构批准的业务	与发行人主营业务无关, 属于财务性投资

如上表所示, 除株洲融兴村镇银行外, 其他被投资企业的主要业务均与发行人的主营业务紧密相关。

2、发行人对上述企业投资后取得的相关资源

发行人主要客户为下游大型高可靠集团和通信、消费电子、汽车电子、工业

装备等领域的大型终端厂商，上述客户对电子元器件等产品的需求种类繁多。为提高生产经营效率，发行人自身聚焦于钽电容器、陶瓷电容器、微电路模块等主要产品的研发、生产和销售，通过对上述企业的投资，可以满足下游客户对相关小批量、个性化产品的需求，丰富产品半径，提升对大型客户的综合服务能力。

发行人始终致力于为客户提供高性能、高品质的产品，并通过不断丰富产品的多元性，以满足客户的综合需求，投资上述企业是发行人实现横向布局战略发展目标的有效手段。报告期内，发行人营业收入分别为 63,631.46 万元、84,404.17 万元、140,085.76 万元和 92,269.95 万元，呈快速上升趋势，其中非钽电容产品占比分别为 18.72%、29.04%、38.81%和 39.35%，呈逐年上升趋势。

3、被投资企业主要财务数据情况

报告期内，上述被投资企业主要财务数据情况如下：

单位：万元

项目	2021年6月30日 /2021年1-6月	2020年12月31日 /2020年度	2019年12月31日 /2019年度	2018年12月31日 /2018年度
展芯半导体：				
资产总额	344.69	349.48	365.48	442.38
负债总额	1.16	1.16	1.16	126.52
所有者权益	343.53	348.32	364.33	315.86
营业收入	-	-	122.29	701.86
净利润	-4.79	-16.00	48.46	70.25
宏讯微电子：				
资产总额	970.50	827.85	301.07	189.87
负债总额	1,057.51	666.79	247.36	54.27
所有者权益	-87.00	161.06	53.71	135.60
营业收入	389.83	521.49	166.20	30.88
净利润	-322.06	-487.65	-459.40	-44.09
芯瓷电子：				
资产总额	390.51	-	-	-
负债总额	107.29	-	-	-
所有者权益	283.21	-	-	-
营业收入	-	-	-	-
净利润	-6.79	-	-	-

株洲融兴村镇银行：				
资产总额	132,134.57	144,390.18	102,534.70	123,521.24
负债总额	118,530.17	131,957.39	90,960.81	112,736.70
所有者权益	13,604.39	12,432.80	11,573.89	10,784.54
营业收入	3,406.78	3,719.16	4,049.07	4,431.68
净利润	1,171.60	1,408.91	1,618.30	2,146.70

注：1、上述数据未经审计。2、君民电子成立于2021年8月，报告期内尚无财务数据。

4、发行人与被投资企业的协同效应情况

根据前述分析，除株洲融兴村镇银行外为财务性投资外，发行人通过投资上述企业能够较好的丰富产品多元性，提升客户综合服务能力，形成较好的协同效应。

（三）自本次发行相关董事会前六个月至今，公司已实施或拟实施的财务性投资的具体情况

本次发行相关事项已经2021年6月4日召开的第二届董事会第二十次会议，审议通过了本次发行的相关议案，自本次发行董事会前六个月至本回复报告签署日，发行人不存在已实施或拟实施的财务性投资情况。

（四）结合营运资金及缺口情况、闲置资金管理情况、未来投资安排等，说明补充流动资金的必要性

1、营运资金及缺口情况

（1）发行人所在行业和业务特性对营运资金需求较大

发行人所在行业和业务特性决定了发行人需要大量的营运资金支持。发行人作为国内高可靠电子元器件和电路模块的主要生产企业，在产品销售、原材料采购和产品研发等环节均对营运资金需求较大，具体包括：

①发行人下游客户集中度较高，存在一定的回款周期

发行人长期服务于多家高可靠领域大型集团，以及通信、消费电子、汽车电子、工业装备等领域的大型终端厂商。经过多年的发展，发行人与前述客户建立了长期稳定的业务合作关系，但在业务合作过程中，前述客户一般回款周期较长，

部分客户还以商业承兑汇票结算，从而占用发行人的营运资金，造成一定资金压力。

②随着发行人业务高速发展，对营运资金的需求亦快速提升

近年来，随着高可靠领域，以及通信、消费电子、汽车电子、工业装备等下游行业的需求增加，发行人营业收入持续增长，最近三年营业收入复合增长率达48.38%，随着本次微波电子元器件生产基地建设项目和研发中心建设项目两个募集资金投资项目的实施，将进一步提高发行人产能和收入规模，对营运资金的需求也将逐步增长。

③资金实力是体现企业竞争力的重要因素之一

发行人下游客户主要为大型高可靠集团、通信、消费电子、汽车电子、工业装备等领域的终端厂商，该类客户通常会将供应商的资金实力作为考虑其抗风险能力的重要指标之一，资金实力亦成为发行人稳固在行业内市场地位的重要因素之一。发行人作为国内知名的高可靠电子元器件和电路模块生产厂商，拥有较强的综合实力，但仍需要通过资本市场拓展融资方式，以应对激烈的市场竞争，因此利用募集资金补充发行人营运资金具有必要性。

(2) 发行人营运资金缺口测算

①测算方法

发行人采用销售百分比法对未来三年的流动资金需求进行测算。销售百分比法是假设经营性流动资产、经营性流动负债与营业收入之间存在稳定的百分比关系，根据预计销售额与相应百分比预计经营性流动资产、经营性流动负债，然后确定流动资金需求。

②相关假设

选取应收票据、应收账款、预付款项和存货作为经营性流动资产测算指标，应付票据、应付账款、合同负债、应付职工薪酬、应交税费作为经营性流动负债测算指标。发行人主营业务、经营模式和经营效率在未来不发生较大变化的前提下，发行人未来各项经营性流动资产、经营性流动负债与销售收入保持较稳定的比例关系。

最近三年，发行人营业收入分别为63,631.46万元、84,404.17万元和140,085.76万元，年均复合增长率为48.38%。根据行业发展情况和发行人自身经营情况，谨慎预计未来三年营业收入的复合增长率为20%。

③测算结果

发行人营运资金及缺口测算过程如下：

单位：万元

项目	2020年度 /2020年12月31日	占营业收入的比例	2021年度 /2021年12月31日	2022年度 /2022年12月31日	2023年度 /2023年12月31日
营业收入	140,085.76	100.00%	168,102.91	201,723.49	242,068.19
应收票据	76,999.63	54.97%	92,399.56	110,879.47	133,055.36
应收账款	65,881.80	47.03%	79,058.16	94,869.79	113,843.75
预付账款	3,222.41	2.30%	3,866.89	4,640.27	5,568.32
存货	57,318.58	40.92%	68,782.30	82,538.76	99,046.51
经营性流动资金合计	203,422.42	145.21%	244,106.90	292,928.28	351,513.94
应付票据	762.13	0.54%	914.56	1,097.47	1,316.96
应付账款	34,146.22	24.38%	40,975.46	49,170.56	59,004.67
合同负债	3,903.62	2.79%	4,684.34	5,621.21	6,745.46
应付职工薪酬	12,800.51	9.14%	15,360.61	18,432.73	22,119.28
应交税费	3,579.90	2.56%	4,295.88	5,155.06	6,186.07
经营性流动负债合计	55,192.38	39.40%	66,230.86	79,477.03	95,372.43
当年流动资金需求	148,230.04	105.81%	177,876.05	213,451.26	256,141.51
当年新增流动资金需求			29,646.01	35,575.21	42,690.25
累计新增流动资金需求			107,911.47		

如上表所示，预计到2023年度，发行人需要补充营运资金107,911.47万元，本次拟利用募集资金补充流动资金20,000.00万元，剩余部分由发行人自有资金解决。

2、闲置资金管理情况及未来投资安排

截至2021年6月30日，发行人账面货币资金余额为24,951.45万元，交易性金融资产为2,085.55万元，合计金额为27,037.00万元。发行人账面货币资金及交易性金融资产使用预算规划如下：

（1）发行人业务高速发展，对营运资金的需求较高

报告期内，发行人营业收入分别为 63,631.46 万元、84,404.17 万元、140,085.76 万元和 92,269.95 万元，呈快速上升趋势，主要系下游市场对钽电容器、陶瓷电容器等电子元器件的需求大幅提升所致。面对市场需求的变化，发行人需保持较快提高产量的能力，以保障产品交付、避免客户流失以及为新客户开拓提供保障。

截至 2021 年 6 月 30 日，发行人应付账款金额为 35,548.27 万元，应付票据金额为 4,425.33 万元，合计 39,973.60 万元。发行人下游客户主要为高可靠领域大型集团，在业务合作过程中，前述客户一般回款周期较长，同时，为保证原材料供应的稳定性、及时性，发行人需对上游供应商的货款及时支付，因此存在一定的资金压力。

（2）发行人业务发展对生产厂房、机器设备等固定资产的持续投入要求较高

报告期各期末，发行人固定资产分别为 14,936.79 万元、21,889.80 万元、21,378.40 万元和 26,019.76 万元，在建工程分别为 2,826.45 万元、1,687.71 万元、26,856.91 万元和 28,699.80 万元，整体呈大幅上升趋势。发行人的业务发展对各类产品的产能需求持续提升，发行人持续投入生产厂房、机器设备等固定资产，以快速响应下游客户的需求增长。

（3）研发项目投入需求

作为创新驱动型企业，技术研发能力是发行人的核心竞争力，除本次募投项目拟建设的研发中心外，发行人还需要以自有资金持续投入新产品研发和工艺改进，以及持续引进优秀研发人才、优化研发团队组织架构，从而保证产品的市场竞争力和客户的综合服务能力。

二、核查程序

保荐机构、会计师执行了如下核查程序：

1、取得发行人最近一期末的财务报表、对外投资明细表、被投资企业基本情况说明等，了解发行人对外投资具体情况；

2、对发行人相关管理人员进行访谈，了解被投资企业主营业务情况，与发

行人业务的相关关系，是否具有协同效应等；

3、结合发行人公开披露的年度报告和中期报告，并对发行人相关管理人员进行访谈，了解发行人自本次发行相关董事会前六个月至今，是否存在已实施或拟实施的财务性投资；

4、取得发行人营运资金缺口测算明细表，并对发行人财务人员进行访谈，了解闲置资金管理情况和未来投资安排。

三、核查意见

经核查，保荐机构、会计师认为：

1、截至 2021 年 6 月 30 日，除持有株洲县融兴村镇银行 10.00% 股权属于财务性投资外，发行人其他对外投资均非财务性投资；

2、除株洲县融兴村镇银行外，发行人对外投资企业均与发行人具有一定的协同效应，并非仅为获得稳定的财务性收益；

3、自本次发行相关董事会前六个月至今，发行人不存在已实施或拟实施的财务性投资；

4、发行人本次补充流动资金具有必要性。

其他问题

请发行人在募集说明书扉页重大事项提示中，重新撰写与本次发行及发行人自身密切相关的重要风险因素，并按对投资者作出价值判断和投资决策所需信息的重要程度进行梳理排序。

一、对问题的回复：

发行人已在募集说明书扉页重大事项提示中，重新撰写与本次发行及发行人自身密切相关的重要风险因素，并按对投资者作出价值判断和投资决策所需信息的重要程度进行梳理排序。具体披露如下：

“（一）应收账款及应收票据回收风险

报告期各期末，公司的应收账款分别为 40,200.00 万元、52,048.17 万元、65,881.80 万元和 **104,537.80 万元**，占总资产的比例分别为 23.94%、26.37%、22.24%和 **30.74%**，应收账款坏账准备计提比例分别为 **7.79%**、**7.56%**、**6.87%**、**5.33%**。公司的应收票据分别为 37,936.74 万元、46,520.62 万元、76,999.63 万元和 **53,949.61 万元**，占总资产的比例分别为 22.59%、23.57%、25.99%和 **15.86%**，应收票据坏账准备计提比例在报告期各期均为 **4.00%**。报告期内，随着公司营业收入的不断增长，应收账款和应收票据规模也不断增长，主要系公司主要客户为大型高可靠集团下属单位，付款周期相对较长所致，大额应收账款和应收票据影响公司资金回笼速度，给公司带来一定的资金压力。如果国际形势、国家安全环境发生变化，导致公司主要客户经营发生困难，进而不能按期付款，**将会导致公司出现应收账款及应收票据无法收回的风险。**

（二）商业承兑汇票无法兑付风险

报告期各期末，公司的商业承兑汇票账面余额分别为 35,611.13 万元、43,491.47 万元、73,570.49 万元和 55,971.95 万元，商业承兑汇票坏账准备计提金额分别为 1,424.45 万元、1,739.66 万元、2,942.82 万元、2,238.88 万元，计提比例均为 4%。发行人商业承兑汇票主要来自于大型高可靠集团，如果客户经营发生困难，则可能出现商业承兑汇票无法兑付的风险。

（三）存货规模增长及存货减值的风险

报告期内，公司业务规模持续增长，导致存货增长较快。公司的存货主要由原材料、在产品、库存商品和发出商品组成。报告期各期末，公司的存货账面价值分别为26,048.82万元、34,815.63万元、57,318.58万元和74,214.46万元，占流动资产比例分别为18.40%、20.71%、24.60%和27.94%。公司存货规模较大，一定程度上占用了公司资金而影响流动性。较高的存货规模仍可能导致计提较大金额的存货跌价准备，进而影响公司的利润水平。报告期各期末，公司分别计提存货跌价准备2,243.61万元、3,475.38万元、4,266.28万元及4,951.05万元。库存量能够保障生产经营的稳定性，但如果原材料、库存商品的行情出现大幅下滑或者公司产品销售不畅、发出商品未能得客户及时验收，而公司未能及时有效应对并做出相应调整，公司将面临存货减值的风险，进而会给公司经营造成一定的不利影响。

（四）毛利率波动的风险

报告期内，公司主营业务毛利率和综合毛利率整体相对较高且呈增长态势，主要受行业景气度较高、下游客户需求不断增加、行业技术和资质壁垒较高、高可靠产品定价具备较大优势、公司竞争力较强以及有效的成本控制严格等多方面因素影响。如果未来出现行业政策变化、下游需求缩紧、市场竞争进一步加剧、原材料价格大幅上涨单方向波动、人工成本大幅增长上升等不利因素，发行人主营业务毛利率和综合毛利率水平可能会出现下滑的风险。

（五）募投项目实施进度风险

截至本募集说明书签署日，发行人“微波电子元器件生产基地建设项目”的建设地尚未办理不动产权证过户并取得相关产权证书。如果发行人一直未能取得产权证书，可能对募投项目实施的整体进度造成一定影响。此外，随着公司相关产品产能的扩张，公司的资产规模及业务复杂度将进一步提升，研发、运营和管理人员将相应增加，如果公司未能根据业务发展状况及时提升人力资源、法律、财务等方面的管理能力，可能会影响项目研发及建设进程，导致项目未能按期投入运营的风险。

（六）募投项目收益未达预期风险

本次募集资金拟用于的项目包括微波电子元器件生产基地建设项目、研发中心建设项目和补充流动资金。虽然公司对本次募集资金投资项目均进行了审慎的可行性论证和充分的市场调查，但在募投项目的实施过程中，公司面临行业发展变化、市场竞争变化、高可靠单位验证周期变化等多重不确定性，可能对实现预期收益的前提条件产生不利影响。此外，如本次募投项目的成本费用无法有效控制，或者公司未能按既定计划完成募投项目，可能会影响募投项目的投资成本、投资回收期、投资收益率等，从而可能导致募集资金投资项目的实际效益与预期存在一定的差异。

（七）募投项目新增产能消化的风险

本次募投项目中，微波电子元器件生产基地建设项目将新增陶瓷电容器产能200,000万只/年，新增环行器及隔离器产能150万只/年，新增产能均可用于高可靠产品和民用产品。在高可靠领域，发行人已与众多高可靠领域集团签订正式协议；在民用领域，发行人现有或潜在客户的需求量较大，但受限于产能不足，尚无法满足相关民用客户的大批量需求，因而尚未签署正式业务协议。通过本次募投项目的实施将有利于缓解现有产能瓶颈，提高产品质量，丰富产品结构，保障企业持续高水平发展。但上述募投项目的必要性和可行性分析是基于当前宏观经济环境、产业发展趋势、市场整体供求关系及公司未来发展战略等因素作出的判断。未来募投项目建设完成并投入实施后，如果行业政策、市场需求和技术发展等方面发生不利变化，将对公司实施募投项目产生不利影响，且如果未来民用产品市场拓展不及预期，可能导致募集资金投资项目投产后新增产能无法及时消化，从而对公司经营业绩产生不利影响。

（八）募投项目新增固定资产折旧和摊销的风险

发行人按照当前执行的折旧与摊销政策，对本次募投项目新增固定资产进行折旧和摊销。微波电子元器件生产基地建设项目预计建成后的年均折旧和摊销金额为7,925.89万元，研发中心建设项目预计建成后的年均折旧和摊销金额为1,829.16万元，合计占公司最近三年平均营业收入的10.16%，可能存在因资产折旧增加导致公司经营业绩受到不利影响的风险。

（九）募投项目研发失败的风险

公司下游的高可靠领域，以及通信、消费电子、汽车电子和工业装备等行业均为高新技术领域。下游行业的技术快速更迭，使得公司等上游电子元器件和电路模块供应商需不断更新和适应新技术的发展，准确把握市场和客户需求变化，适时布局新产品，不断研发新工艺。本次募投项目之研发中心建设项目实施后，公司每年研发投入支出将存在一定幅度的提升，将对当期业绩产生影响。

此外，本次募投项目建设的超宽带嵌入式板卡相关产品技术壁垒相对较高、研发难度较大，需要一定的技术和研发人才储备。如果公司出现人才流失，或者无法突破研发难点的情形，则可能导致研发失败，将会对公司的经营情况产生一定的不利影响。

（十）宏观环境变化的风险

公司致力于电子元器件及电路模块的研发、生产和销售，主营业务包括高可靠产品和民用产品两大类，以提供高可靠电子元器件及解决方案为主。高可靠产品领域作为特殊的经济领域，主要受国际环境、国际安全形势、地缘政治以及国防发展水平等多种因素影响。若未来国际形势或国家安全环境出现重大变化，则可能对公司生产经营产生不利影响。

（十一）行业管理体制变化的风险

企业从事高可靠业务需要取得相关业务资质，并具备高程度的技术壁垒，且基于稳定性、可靠性、保障性等考虑，高可靠产品一般均由原研制、定型厂家保障后续生产供应。但在国家持续鼓励高可靠行业发展的情况下，越来越多的民营企业参与到高可靠行业的发展中来。同时，政府对于民营高可靠企业，在具体管理制度上更为市场化，更加灵活。若行业管理体制、市场进入条件等发生变化，可能会吸引新的竞争对手进入，导致公司所在行业竞争加剧，将对公司生产经营环境产生重大影响。

（十二）公司规模迅速扩张导致的管理风险

随着公司快速发展，公司销售收入快速增长，业务规模不断扩张，涉及业务领域不断增加，在产品研发、资源整合、质量管理、财务管理和内部控制等方面对公司提出更高的要求。虽然公司目前已积累了丰富的管理经验，完善了公司治理结构，形成了有效的内部激励和约束机制，但如果公司管理水平不能在经营规

模扩大的同时适时调整和优化管理体系、完善内部控制制度、提升经营管理水平，适应业务、资产及人员规模迅速扩张的需要，将对公司竞争力的持续提高、未来研发及生产的组织管理产生不利影响。”

二、核查意见

经核查，保荐机构认为：

发行人已在募集说明书扉页重大事项提示中，重新撰写与本次发行及发行人自身密切相关的重要风险因素，并按对投资者作出价值判断和投资决策所需信息的重要程度进行梳理排序。


（以下无正文）

（此页无正文，为《关于株洲宏达电子股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核问询函的回复报告》之签署页）

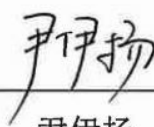


(此页无正文，为《关于株洲宏达电子股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核问询函的回复报告》之签署页)

保荐代表人签名：



方磊



尹伊扬



保荐机构董事长声明

本人已认真阅读《关于株洲宏达电子股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核问询函的回复报告》的全部内容，了解本回复报告涉及问题的核查过程、本公司的内核和风险控制流程，确认本公司按照勤勉尽责原则履行核查程序，本回复报告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对上述文件的真实性、准确性、完整性、及时性承担相应法律责任。

董事长、法定代表人签名：



沈如军



保荐机构首席执行官声明

本人已认真阅读《关于株洲宏达电子股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核问询函的回复报告》的全部内容，了解本回复报告涉及问题的核查过程、本公司的内核和风险控制流程，确认本公司按照勤勉尽责原则履行核查程序，本回复报告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对上述文件的真实性、准确性、完整性、及时性承担相应法律责任。

首席执行官签名：


黄朝晖

